

목 차

분 기 보 고 서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요.....	3
1. 회사의 개요.....	3
2. 회사의 연혁.....	6
3. 자본금 변동사항.....	12
4. 주식의 총수 등.....	14
5. 의결권 현황.....	14
6. 배당에 관한 사항 등.....	15
II. 사업의 내용	17
III. 재무에 관한 사항	43
IV. 감사인의 감사의견 등	50
V. 이사의 경영진단 및 분석의견.....	54
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항.....	55
1. 이사회에 관한 사항	55
2. 감사제도에 관한 사항.....	61
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.....	64
4. 계열회사 등의 현황	64
VII. 주주에 관한 사항.....	75
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....	81
1. 임원 및 직원의 현황	81
2. 임원의 보수 등	88
IX. 이해관계자와의 거래내용.....	92
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	93
XI. 재무제표 등	97
XII. 부속명세서	112
【 전문가의 확인 】	115
1. 전문가의 확인.....	115
2. 전문가와의 이해관계.....	115

분기보고서

(제 67 기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
 2014년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2014년 05월 15일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 성 욱

본 점 소 재 지 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) <http://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무본부장 (성 명) 이 명 영

(전 화) 02-3459-5541~8

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

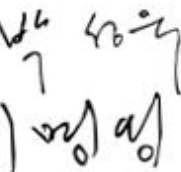
또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2014. 05. 15

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 박 성 욱

공시 책임자 이 명 영



I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스는 이천, 청주의 국내 사업장을 비롯하여 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 생산 공장과 10개 판매 법인 및 18개의 국내외 사무소를 두고 있는 글로벌 기업으로서 지속적인 연구개발 및 투자로 기술 및 원가 경쟁력을 확보하고 있으며, 세계 반도체시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

당사의 개요와 관련한 보다 자세한 내용은 다음과 같습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
				도말 자산총액		
에스케이하이엔지(주)	2001.04	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	56,725	의결권 과반수 소유	○
에스케이하이텍(주)	2008.03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	29,906	의결권 과반수 소유	X
SK hynix America Inc.(SKHYA)	1983.03	3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A.	반도체 판매	964,682	의결권 과반수 소유	○
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc.(HSMA)	1995.07	1830 Willow Creek Circle, Eugene OR,97104, U.S.A.	반도체 생산	50,710	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	1989.03	Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str.16, D- 65479 Raunheim, Germany	반도체 판매	98,150	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE)	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 ORH, U.K.	해외현지 투자 지주회사	0	의결권 과반수 소유	X
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 ORH, U.K.	반도체 판매	78,020	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Asia Pte.Ltd.(SKHYS)	1991.09	7 Temasek Boulevard #42-02 Suntec City Tower1 Singapore 038987	반도체 판매	231,649	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor India PrivateLtd.(SKHYIS)	2006.11	Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB(International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India	반도체 판매	1,647	의결권 과반수 소유	X
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	1995.04	Suite 2401, 24F., Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong	반도체 판매	353,248	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	2001.08	Room 2702-2705, Maxdo Center, No.8, Xing Yi RD, Changning Zone, Shanghai, China	반도체 판매	33,845	의결권 과반수 소유	X

SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1996.09	23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomom, Minatoku, Tokyo	반도체 판매	302,971	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	1996.07	11F, No.392, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei11492, Taiwan, R.O.C.	반도체 판매	240,489	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	2005.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼 생산 및 판매	3,652,044	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	2006.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼 생산 및 판매	249,498	의결권 과반수 소유	○
SK hynix(Wuxi) Semiconductor SalesLtd.(SKHYCW)	2010.08	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	반도체 판매	5,362	의결권 과반수 소유	X
SK hynix Italy S.r.l.(SKHYIT)	2012.05	V.le Colleoni 15, Palazzo Orione 20864 Agrate Brianza (MB), Italy	기술센터	4,781	의결권 과반수 소유	X
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	2012.08	2550 Walsh Avenue, Suite 200, Santa Clara, CA 95051	기술센터	14,548	의결권 과반수 소유	X
SK hynix Flash Solutions Taiwan Ltd.(SKHYFST)	2012.08	Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan	기술센터	8,246	의결권 과반수 소유	X
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	2013.09	Wanchai, Hong Kong	해외현지 투자 지주회사	53,079	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor (Chongqing)Ltd.(SKHYCQL)	2013.09	Chongqing, China	웨이퍼 생산 및 판매	52,857	의결권 과반수 소유	○

※ 주요 종속회사 판단기준: 직전 사업연도말 자산총액 500억원 이상

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091
전화번호: 031-630-4114
홈페이지: <http://www.skhynix.com>

마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 반도체소자 제조 및 판매
- 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
- 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
- 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
- 기계부분품 제조업 및 금형제조업
- 기술연구 및 용역수탁업
- 전자 전기기계, 기구의 임대업
- 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
- 정보서비스업
- 출판업
- 무역업
- 부동산 매매 및 임대업
- 발전업
- 건설업
- 전자관 제조업
- 창고업
- 주차장업
- 위성통신사업
- 전기통신회선설비 임대사업
- 전자상거래 및 인터넷 관련사업
- 전기 각호와 관련된 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 기업집단의 명칭 : SK계열

(2) 기업집단에 소속된 회사 (2014. 3. 31일 기준 계열사 : 80개사)

업종	상장사	비상장사
지주회사(1)	SK(주)	-

에너지·화학 (34)	SK이노베이션(주), SK케미칼(주), SKC(주), SK가스(주), ㈜부산도시가스	SK E&S(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), (주)대한송유관공사, SK모바일에너지(주), 충청에너지서비스(주), 영남에너지서비스(주), 이니츠(주), 전북에너지서비스(주), 전남도시가스(주), 강원도시가스(주), 평택에너지서비스(주), 엔티스(주), SK유화(주), SKC에어가스(주), 코원에너지서비스(주), SK더블유(주), 유베이스매뉴팩처링아시아(주), 울산아로마텍스(주), 김천에너지서비스(주), 위례에너지서비스(주), 하남에너지서비스(주), 지허브(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), 보령LNG터미널(주), SK컨티넨탈이모션코리아(주), 피엠피(주)
정보통신/ 전기전자 (21)	SK텔레콤(주), SK커뮤니케이션즈(주), SK브로드밴드(주), SK C&C(주), SK하이닉스(주), ㈜실리콘화일, SKC솔믹스(주)	SK플래닛(주), SK텔레시스(주), SK텔링크(주), 인포섹(주), ㈜커머스플래닛, 텔레비전미디어코리아(주), 서비스에이스(주), 서비스탑(주), 넷웍오앤에스(주), SKC라이팅(주), (주)에이앤티에스, 엘씨앤씨(주), 비젠(주), 피에스앤마케팅(주)
건설/물류/서비스 (19)	SK네트웍스(주)	SK건설(주), SK해운(주), 행복나래(주), SK디앤디(주), 엠앤서비스(주), 에프앤유신용정보(주), SK네트웍스서비스(주), SK핀크스(주), SK하이스택(주), 내트럭(주), 앤츠개발(주), SK신택(주), 스피드모터스(주), SK하이이엔지(주), 엠케이에스개런티(유), SK임업(주), 대전맑은물(주), 광주맑은물(주)
금융(1)	SK증권(주)	-
기타(4)	㈜유비케어	SK바이오팜(주), SK와이번스(주), 제주유나이티드FC(주)

(*) 사명 변경 : 울산아로마텍스(주) (舊 아로케미(주)), 행복나래(주) (舊 엠알오코리아(주)), 비젠(주) (舊 텔스(주)), SK하이스택(주) (舊 (주)하이스택), SK하이이엔지(주) (舊 (주)하이닉스엔지니어링), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주))

사. 신용평가에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 다음과 같습니다.

구분	평가기관	현등급	최종평가일
국내	NICE신용평가	A+	2013.06.27
	한국기업평가	A+	2013.06.20
	한국신용평가	A+	2013.06.20
해외	Moody's	Ba2	2013.08.20
	S&P	BB+	2013.12.05

최근 3개 사업연도 신용등급과 관련한 상세 내역 및 각 등급에 따른 정의는 본 보고서 'II. 11. 나. 최근 3년간 신용등급'을 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 중요한 변동상황

(1) 회사의 주된 변동내용

- 1949. 10 국도건설 주식회사 설립
- 1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 1996. 12 기업공개 및 상장
- 1997. 03 대표이사 김영환 외 이사 5인 변경 선임
이사 5인, 감사 1인 변경 선임
- 1999. 05 LG그룹과 LG반도체 주식 양수도 계약 체결
- 1999. 07 LG반도체 대주주 지분 인수
- 1999. 10 현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
- 2000. 03 박종섭 대표이사 외 이사 1인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2000. 05 전장사업부문 (주)현대오토넷으로 분사
- 2000. 08 모니터사업부문 "현대이미지퀘스트(주)"로 분사
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
박상호 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2001. 05 통신단말기 사업부문 "현대큐리텔"로 분사
통신 ADSL 사업부문 "현대네트웍스"로 분사
- 2001. 07 통신 네트워크 사업부문 "현대시스콤"으로 분사
- 2001. 08 현대그룹으로부터 계열분리
- 2001. 10 채권금융기관 공동관리 시작
- 2001. 12 현대큐리텔, '팬텍 컨소시엄'에 지분 매각
- 2002. 01 현대시스콤, '쓰리알'에 지분 매각
- 2002. 05 시러스 로직社와 파운드리 전략적 장기공급 계약체결
박종섭 대표이사 사임
- 2002. 06 최대주주 변경(현대상선(주) → (주)한국외환은행)
- 2002. 07 우의제 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2002. 12 현대네트웍스, '엠비엔'에 지분 매각
- 2003. 02 박상호 대표이사 사임
- 2003. 04 STMicro社와 낸드플래시 메모리 공동 개발 및 파운드리 공급 계약 체결
- 2003. 06 환경/안전/보건 기술연구소 설립
- 2004. 06 매그나칩반도체 유한회사와 비메모리 사업부문 영업양도계약 체결
- 2004. 08 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시와 중국 현지공장설립 협력계약 체결
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2004. 11 STMicro社와 중국 현지 합작공장설립을 위한 협력계약 체결
- 2005. 03 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호 사외이사 선임
박시룡, 장윤중 사외이사 임기만료 퇴임
- 2005. 07 채권금융기관 공동관리 조기종료
현대이미지퀘스트(주), (주)빅터스캐피탈코리아에 지분 매각
- 2005. 10 (주)현대오토넷 지분매각 완료

- 출자전환주식 공동관리협의회 1차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
2006. 03 권오철 이사, 손방길 사외이사 선임, 정형량 이사 임기만료 퇴임
2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
2006. 06 출자전환주식 공동관리협의회 2차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
2006. 09 300mm 연구소(R3 R&D Fab) 개소
2007. 03 김종갑 대표이사 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 4인 포함) 선임
- 이사 선임: 김종갑, 최진석
 - 사외이사 선임: 박종선, 김경한, 조동성, 김형준
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호
- 우의제 대표이사 임기만료 퇴임
- 이사 1인(오춘식), 사외이사 4인(김범만, 김수창, 이선, 이준호) 임기만료 퇴임
2007. 04 청주 신규 M11(300mm) 공장 착공
2007. 07 공정거래 자율준수프로그램 도입
2007. 10 환경운동연합과 '환경경영검증위원회' 협약 체결
2007. 11 '일하는 이사회'를 위한 신(新)이사회 제도 도입
2008. 02 김경한 사외이사 중도 퇴임
2008. 03 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
- 사외이사 3인(황학중, 민형욱, 손방길) 임기만료 퇴임
2008. 06 정홍원 사외이사 중도 퇴임
2009. 03 권오철 이사 재선임 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 이사 선임: 권오철, 박성욱
 - 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
2009. 11 중국 후공정 합작사 HITECH 설립
2010. 03 최대주주 변경((주)한국외환은행 → 한국정책금융공사)
- 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 미래에셋자산운용투자자문(주))
- 권오철 대표이사외 이사 1인 신규 선임, 김종갑 이사 재선임
- 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 이사 선임: 김종갑, 권오철, 김민철
 - 사외이사 선임: 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 김창호
2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
2010. 08 최대주주 변경(미래에셋자산운용투자자문(주) → 한국정책금융공사)
2010. 10 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 국민연금공단)
2011. 03 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임

- 사외이사 선임: 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑희, 정상환
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 조현명
- 2011. 09 정상환 사외이사 중도 퇴임
- 2012. 02 최대주주 변경(국민연금공단 → 에스케이텔레콤(주))
사외이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
 - 이사 선임: 최태원, 하성민, 박성욱
 - 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
- 2012. 06 미 컨트롤러 업체 LAMD(Link_A_Media Devices) 인수 본계약 체결
- 2012. 09 플래시 솔루션 디자인 센터 설립
- 2013. 03 김준호 사내이사 1인 신규 선임
- 2014. 03 이사 2인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임
 - 이사 선임: 임형규
 - 사외이사 선임: 최종원
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원

(2) 주요종속회사의 주된 변동내용

- 1983. 03 미국 현지법인(HSA) 설립
- 1989. 03 독일 현지법인(HSD) 설립
- 1991. 08 싱가포르 현지법인(HSS) 설립
- 1995. 04 홍콩 현지법인(HSH) 설립
- 1995. 07 영국 현지법인(HSE) 설립
영국 현지판매법인(HSU) 설립
- 1995. 08 미국 생산법인(HSMA) 설립
- 1996. 07 대만 현지법인(HST) 설립
- 1996. 09 일본 현지법인(HSJ) 설립
- 2001. 05 사업지원 서비스부문 "(주)현대아스텍" 분사
- 2001. 07 LCD 사업부문 "(주)현대디스플레이테크놀로지"로 분사
- 2001. 08 중국 현지판매법인(HSCS) 설립
- 2001. 12 "에스알씨(주)" 분사
- 2002. 11 "(주)현대디스플레이테크놀로지" TFT-LCD 사업부문 매각
- 2005. 04 중국 합작법인(HSSL) 설립
에스알씨(주)→(주)큐알티반도체 사명 변경
(주)현대아스텍→(주)아스텍 사명 변경
- 2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
- 2006. 10 중국 현지생산법인(HSMC) 준공
- 2007. 01 인도 현지법인(HSIS) 설립
- 2008. 03 (주)아스텍에서 (주)하이닉스인재개발원 분할

- (주)아스텍에서 (주)하이테크으로 분할
- (주)아스텍에서 (주)하이로지텍으로 분할
- (주)아스텍에서 (주)하이닉스엔지니어링으로 분할
- 2010. 01 (주)하이닉스엔지니어링에서 (주)아미파워로 분할
- 2010. 08 중국 현지판매법인(HSCW) 설립
- 2011. 09 "(주)현대디스플레이테크놀로지" 청산, 주요종속회사 제외
"프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁" 청산, 주요종속회사 제외
- 2012. 06 낸드플래시 개발업체 아이디어플래시(Ideaflash S.r.l.) 인수, 이탈리아 기술센터(SK Hynix Italy S.r.l.) 전환 설립
- 2012. 10 (주)하이닉스엔지니어링, (주)큐알티반도체 흡수합병
(주)하이테크, (주)하이로지텍/(주)하이닉스인재개발원 흡수합병
- 2012. 10 (주)하이닉스엔지니어링→에스케이하이이엔지(주) 사명 변경
(주)하이테크→에스케이하이테크(주) 사명 변경
- 2013. 09 아미파워(주) 청산, 주요종속회사 제외

나. 상호의 변경

- 1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
- 2012. 03 에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·양도 등

- 1999. 10 현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2011. 11 에스케이텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약
- 2014. 01 (주)실리콘화일과 포괄적 주식교환계약

라. 생산설비의 변동

- 2006. 10 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 C2(300mm), C1(200mm)공장 준공
- 2008. 07 미국 유진 공장 E1(200mm) 가동 중단
- 2008. 08 청주 신규 NAND Flash 전용 M11공장(300mm) 준공
- 2008. 09 이천 M7(200mm) 및 청주 M9(200mm) 공장 가동 중단
- 2008. 12 중국 C1(200mm) 공장 가동 중단
- 2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
- 2012. 06 청주 신규 NAND Flash 전용 M12공장(300mm) 준공

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 2005. 01 전력 소모 30% 줄인 서버용 메모리 모듈 개발
- 2005. 01 대만 프로모스사와 전략적 제휴를 위한 본계약 체결
- 2005. 07 2GB DDR2-667 노트북용 모듈 업계 최초 인텔사 인증 획득
- 2005. 07 당사 출자전환 주식 공동관리 협의회와 '특별 약정' 체결
- 2005. 11 JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발
- 2005. 12 512Mb GDDR4 DRAM 개발
- 2006. 03 80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득
- 2006. 12 200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈 개발
- 2007. 03 ECC회로 적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
- 2007. 04 퓨전메모리 제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산
- 2007. 05 80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품 및 모듈 인텔사 인증 획득
초박형(25 μ m) 20단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
- 2007. 08 200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발
이노베이티브 실리콘사와 신개념 메모리 'ZRAM' 라이선스계약 체결
- 2007. 09 초박형(25 μ m) 24단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package)개발
- 2007. 10 오보닉스사와 차세대 메모리 'PRAM' 기술 라이선스 계약 체결
- 2007. 11 1Gb GDDR5 개발
50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득
실리콘화일사와 CMOS 이미지 센서(CIS) 사업 추진을 위한 협력 계약 체결
- 2008. 01 50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈 인텔사 인증 획득
- 2008. 03 피델릭스사와 전략적 제휴를 위한 협력계약 체결
- 2008. 04 그란디스사와 'STT-RAM' 라이선스 및 공동개발계약 체결
- 2008. 05 프로모스사와 포괄적 제휴 협력 계약 체결
- 2008. 06 파이슨사와 낸드플래시 응용제품 기술에 대한 사업협력계약 체결
실리콘화일사 지분취득 결정 및 기존 파운드리 계약범위 확대
3중셀(X3) 기술 기반 32Gb 낸드플래시 개발
- 2008. 07 씨엔에스테크놀로지사와 시스템반도체 공동개발 및 파운드리 협력계약 체결
- 2008. 08 뉴모닉스사와 낸드플래시 기술 및 제품 공동 개발 협력계약 체결
16GB 서버용 모듈 개발
- 2008. 12 8단 적층 낸드플래시 개발
50나노급 2Gb 고용량 모바일 DRAM 개발
- 2009. 01 DDR3 서버용 모듈 4GB ECC UDIMM 인텔사 인증 획득
- 2009. 02 40나노급 DDR3 DRAM 개발
- 2009. 05 뉴모닉스사 및 파이슨사와 낸드플래시 응용제품용 컨트롤러 3자 공동개발 계약 체결
중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 무석산업발전집단유한공사와 합작 반도체 후공정 전문회사 설립을 위한 본계약 체결
- 2009. 06 4GB 1333Mbps 노트북용 모듈 외 10건 인텔사 DDR3 전용 플랫폼 인증획득
- 2009. 07 대만 프로모스사와 전략적 제휴 협력계약 종결

2009. 08	50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔社 인증 획득
2009. 10	2세대 1Gb DDR3 개발
2009. 12	40나노급 2Gb GDDR5 개발
2010. 01	40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발
2010. 02	20나노급 64Gb 낸드플래시 개발
2010. 09	휴렛팩커드(HP)社와 Re램 공동개발 계약 체결
2010. 12	30나노급 4Gb DDR3 개발
2011. 03	30나노급 2Gb DDR4 개발
2011. 07	도시바社와 STT-MRAM 공동개발 및 합작사 설립을 위한 공동생산 계약 체결
2012. 03	30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품 인증 획득
2012. 04	스팬션社와 특허사용 크로스라이선스 및 SLC낸드플래시 공급계약 체결
2012. 06	IBM社와 PC램 공동개발 및 기술 라이선스 계약 체결
2012. 08	20나노급 64Gb 낸드플래시 저탄소제품 인증 획득
2012. 09	20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발
2013. 06	20나노급 8Gb LPDDR3 개발 램버스社와 포괄적 특허 라이선스 계약 체결
2013.07	삼성전자와 반도체 특허 크로스라이선스 계약 체결
2013.10	20나노급 6Gb LPDDR3 개발
2013.12	20나노급 8Gb LPDDR4 개발
2014.04	20나노급 8Gb DDR4기반 128GB 모듈 개발

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	
2009년 01월 17일	유상증자(일반 공모)	보통주	60,000,000	5,000	5,400	
2009년 02월 18일	주식매수선택권 행사	보통주	18,260	5,000	5,000	
2009년 05월 06일	전환권행사	보통주	12	5,000	24,184	
2009년 05월 19일	유상증자(일반 공모)	보통주	70,000,000	5,000	10,350	
2009년 06월 23일	주식매수선택권 행사	보통주	4,600	5,000	5,000	

2009년 08월 13일	전환권행사	보통주	8,731	5,000	23,328	2009.08.13~2009.09.21
2009년 09월 22일	주식매수선택권 행사	보통주	3,740	5,000	5,000	
2009년 12월 14일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2010년 01월 04일	전환권행사	보통주	28,608	5,000	23,328	2010.01.04~2010.03.22
2010년 04월 01일	전환권행사	보통주	565,120	5,000	23,328	2010.04.01~2010.06.25
2010년 07월 08일	전환권행사	보통주	44,150	5,000	23,328	2010.07.08~2010.09.01
2010년 10월 29일	전환권행사	보통주	115	5,000	23,328	2010.10.29~2010.11.16
2011년 01월 13일	전환권행사	보통주	434,385	5,000	23,328	2011.01.13~2011.03.25
2011년 04월 01일	전환권행사	보통주	1,460,643	5,000	23,328	2011.04.01~2011.06.10
2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2012.02.13
2012년 02월 14일	유상증자(제3자 배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000	
2012년 02월 15일	전환권행사	보통주	4,159	5,000	23,328	2012.02.15~2012.02.23
2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328	
2012년 05월 02일	주식매수선택권 행사	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수선택권 행사
2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2012년 08월 20일	전환권행사	보통주	21	5,000	23,328	
2012년 10월 30일	주식매수선택권 행사	보통주	30,300	5,000	22,800	우리사주매수선택권 행사
2012년 12월 07일	전환권행사	보통주	3,016	5,000	23,328	2012.12.07~2012.12.18
2013년 02월 13일	전환권행사	보통주	9,527	5,000	23,328	2013.02.13~2013.03.28
2013년 04월 01일	전환권행사	보통주	551,689	5,000	23,328	2013.04.01~2013.06.27
2013년 07월 02일	전환권행사	보통주	15,483,908	5,000	23,328	2013.07.02~2013.08.05

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2014.03.31)

(단위 : 원, 주)

종류\구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상	전환청구가	전환조건		미상환사채		비고
						전환비율	전환가액	권면총액	전환가능주식	

				주식의 종류	능기간	(%)			수	
제7회 해외 공모 무보증 전환사채	2010년 05월 14일	2015년 05월 14일	US\$500,000,000	보통주	2011.05.15 ~ 2015.04.28	100	34,394	US\$500,000,000	16,482,526	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	16,482,526	-

※ 상기 '권면총액'은 최초발행시의 권면총액이며, '미상환사채의 권면총액'은 기준일 현재의 잔액 기준임.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2014년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,704,178,735주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당분기말 현재의유통주식수는 보통주 710,200,891주 입니다.

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,704,178,735	-	5,704,178,735	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,993,977,844	-	4,993,977,844	-
1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합(21:1)
2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	710,200,891	-	710,200,891	-
V. 자기주식수	-	-	-	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	710,200,891	-	710,200,891	-

5. 의결권 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	710,200,891	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	710,200,891	-
	우선주	-	-

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

(2) 제54조(중간배당)

- ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
- ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- ⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제67기 1분기	제66기	제65기
주당액면가액 (원)		5,000	5,000	5,000
당기순이익 (백만원)		875,358	2,796,967	-489,990
주당순이익 (원)		1,233	3,938	-719
현금배당금총액 (백만원)		-	-	-
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
현금배당성향 (%)		-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률 (%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당 (주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었으며, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2013년 12월, 금액기준)에 따르면, 지난 2013년도 세계 반도체 시장규모는 US\$3,154억에 이르렀으며, 이중 메모리 제품은 US\$701억의 시장규모를 기록하며 전체 반도체 시장의 약 22% 수준에 달하였습니다. 또한 메모리 반도체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 DRAM은 지난 2013년 US\$356억을 기록하며 전체 메모리 시장의 약 51%를 차지하였고, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US\$293억으로 42%, 노어플래시가 US\$28억으로 4%를 차지하였습니다.

아래 표에 나타낸 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 산업 생산 및 수출에 있어서 10.3%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2013년 반도체 수출은 2012년 세계 반도체 투자 감소의 영향과 DRAM 시장개편 그리고 경기회복 추세에 따라 전년 대비 13.3% 증가하였습니다.

※ 전체 수출중 반도체 비중

(단위: 백만USD, %)

구분	2013	2012	2011	2010	2009
총수출	559,649	548,076	555,214	466,384	363,534
반도체	57,741	50,949	50,879	51,464	31,918
전년비 증감율	13.3	0.1	-1.1	61.2	-2.7
비중	10.3	9.3	9.2	11.0	8.8

출처 : 관세청, 2014년 1월

가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전

제품의 디지털화에 따라 스마트TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다.

낸드플래시 제품이 주로 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응의 중요성이 커지고 있습니다.

나) 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분류가 되며, 자사는 이중 CIS를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 비메모리 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있으며, 특히 CIS의 사용 분야 중 스마트폰과 태블릿PC향의 출하량과 매출 비중이 각각 50%를 넘어 고성장 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화 되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 IT기기화 되어 감에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다.

2011년에는 유럽 재정위기로 인한 저성장 그리고 2012년에는 -3% 역성장을 기록하기도 했습니다만, 2013년 전체 반도체는 5.2% 메모리 반도체 분야는 26%의 높은 성장을 기록하여 2010년을 뛰어넘는 최대 매출을 보였습니다. 2014년 또한 DRAM 수요는 PC에서 모바일과 서버 영역으로, NAND 수요는 모바일에서 PC/Server 대용량 스토리지 영역으로 주요 수요처가 확대되며 지속적인 성장이 예상됩니다.

메모리 반도체 시장의 지속 성장 전망에 반해 생산(공급) 측면은 정체가 예상됩니다. 공정 미세화 기술은한계에 다다르고 있으며, 생산 및 연구 개발을 위한 투자 비용 급증, 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 더욱 다양화, 고도화되고 있어 선발업체와 후발업체의 기술 및 원가 경쟁력 격차가 점차 확대되고 있습니다. 이에 기존과 같은 외형 경쟁을 위한 공급 확대는 제한적일 것으로 보입니다. 향후 메모리 반도체 산업은 안정적 수요와 제한적인 공급으로 인해 메모리 시장 성장의 기회가 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

[DRAM]

시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2014년 3월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 세계 경제 침체의 영향으로 인한 PC 수요 감소로 2012년에는 2011년 보다 11.3% 하락한 US\$262억을 기록했습니다. 반면, 2013년에는 점진적 경기 회복 및 모바일 시장 확대, 수급 안정 등의 요인으로 전년대비 34% 상승한 \$350억의 매출을 거두

있습니다. 분야별로 살펴 보면, PC 시장은 경기 침체로 인한 저성장 기조가 유지되어 DRAM 수요를 견인하는데 어려움을 겪고 있으나, 2014년 4월 Windows XP의 서비스 종료를 전후로 노후 PC의 교체 수요 발생이 예상되며, 개인용 컴퓨터의 이동성(Mobility)에 대한 요구가 증가함에 따라 울트라북 등 노트북 컴퓨터로의 교체 및 신규 수요가 확대될 전망입니다. 한편, 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 모바일 기기는 DRAM 수요를 견인하는 주요 분야로서, 스마트폰과 태블릿PC에서 채용하는 DRAM 용량은 2013년 각각 0.75GB와 0.92GB에서 2017년에는 2GB와 2.3GB로 증가될 것(Gartner, 2014년 3월)으로 예상됩니다. 또한, 고화질의 콘텐츠 유통 증가와 주요 게임 콘솔의 출시에 따라 이를 빠르게 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 증가할 전망입니다. 상기와 같이 디지털 기기의 증가에 따른 DRAM 수요 증가뿐만 아니라, 대용량 콘텐츠 처리를 위한 기기당 탑재량 증가에 따라 DRAM 수요는 앞으로도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2014년 3월, 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은, 2012년에는 다소 성장이 정체되어 -3.7%로 역성장 하였으나, SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 2013년에는 23%(\$289억)의 고성장을 이루었으며, 2014년에도 9.8%(\$317억)의 성장이 전망됩니다. 이는 스마트폰, 태블릿PC를 포함한 휴대용 기기 및 PC용 SSD, 기타 응용복합 제품 등 향후 낸드플래시의 수요를 견인할 제품 시장의 지속적 성장 전망에 기반한 것입니다. 향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가 전개되며 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 일부 HDD를 대체하고 NAND 시장은 세 번째 도약을 할 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라 등 다양한 분야에 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 스마트폰, 태블릿PC의 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다. 가트너(Gartner, 2013년 12월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지 센서 시장은 2017년 US\$112억 규모로 2012년 이래 연평균 3.7%의 성장이 예상되며, 특히 당사가 생산중인 CMOS 이미지 센서 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서의 비중이 2012년 79.2%에서 2017년 85.7%까지 증가하며 연평균 5.4%의 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다. 실제로 메모리 반도체의 경우 미국과 유럽의 매출액 비중은 2011년 23%에서 2017년 11%로 축소가 예상되는 반면, 아시아 지역의 매출액 비중은 2011년 69%에서 2017년 85%로 크게 증가할 전망입니다(Gartner, 2013년 12월, 금액기준).

[DRAM]

DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC 교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 모바일로 이동하고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모

습도 나타나고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는 IT 기기가 스마트화 되고 고성능화 됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 SSD 등으로 바뀌고 있으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿PC, 노트북/PC/Server/Storage/Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스/후방 카메라, 스마트TV 등 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 이미지 센서 중 자사가 생산중인 CMOS 이미지 센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 매우 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 가격경쟁력을 지닌 제품을 적시에 출시하여 시장을 선점하는 것이 사업 성공에 있어 매우 중요한 요소라 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 인적자원(R&D 및 엔지니어링), 2. 기술 및 원가 경쟁력, 3. 시장 대응 능력(고객 확보, 제품 포트폴리오) 4. 설비투자 능력 등이 있습니다. 최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다. 지금까지는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 주요 경쟁요소였으며 사업 성공 요인이었지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화함에 따라 앞으로는 생산기술의 초고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용 복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via), New Memory의 원활한 초기시장 진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도 중요한 경쟁요소로서 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2014년 1분기는 계절적 비수기임에도 불구하고 우시 공장 생산 정상화 및 PC OEM고객들의 재고 확보 수요 증가 등으로 인해 매출이 증가하였으며, Main Memory 제품 중심의 판매 수량 증가 및 안정적 DRAM 가격 환경이 지속됨에 따라 영업이익 규모 또한 확대되었습니다.

당사의 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 약 35% 증가한 약 3조 7천 4백 3십억원을 기록하였으며, 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 약 234% 증가한 약 1조 6백억원으로 대폭 증가하였습니다. 당기순이익 또한 약 8천 2십억원으로 전년 동기 대비 349% 가량 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제67기 1분기 (2014.01.01~ 2014.03.31)	제66기 4분기 (2013.10.01~ 2013.12.31)	전기 대비 증감	제66기 1분기 (2013.01.01~ 2013.03.31)	전년 동기 대비 증감
매출액	3,742,690	3,367,687	11.2%	2,781,147	34.6%
영업이익	1,057,266	784,751	34.7%	316,951	233.6%
당기순이익	802,254	789,147	1.7%	178,713	348.9%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제66기]

(단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	3,742,690	100.0%	DRAM, NAND Flash, MCP 등
합계	3,742,690	100.0%	

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자부품 제조업(분류번호: 321)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율 등

구 분	'13년	'12년	'11년	'10년	'09년
DRAM	26.6%	24.7%	22.8%	21.8%	22.9%
NAND Flash	12.8%	11.8%	11.7%	9.5%	8.4%

출처: IDC, 2014년 3월, 매출액 기준

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

(가) 메모리반도체 사업

[DRAM]

컴퓨팅 메모리(Computing Memory) 사업의 경우 가격이 높고 품질의 신뢰성이 바탕이 되어야 하는 고용량(High Density) 서버용 제품 비중과 이동성 확대에 따른 노트북(Notebook) 및 울트라북(Ultrabook)제품의 비중이 확대되고 있습니다. 2014년 PC 시장은 Mobile Device에 의한 PC 수요 잠식 지속으로 2013년 대비 PC 출하량 하락이 예상되고 있습니다. 이 중 휴대성과 편의성이 강조된 울트라북은 PC 중 판매 비중이 지속적으로 증가하며 태블릿PC와 함께 긍정적인 성장이 전망됩니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)과 스마트 기기의 성장에 따른 인터넷 데이터 트래픽의 폭발적인 증가로 인하여 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 특히 대형 인터넷 포털 업체의 데이터 센터는 서버 시스템 수요를 빠르게 증가시키고 있는 추세입니다. 당사는 TCO(Total Cost of Ownership) 절감을 중요시하는 데이터 센터의 제품 효율성 요구 증대에 부응하기 위해 저전력과 고속의 서버용 모듈(Module) 제품을 공급 하고 있으며, 그 외에도 저전력 Micro Server용 신규 제품군을 새롭게 개발하여 서버 메모리 트렌드에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory)는 동영상 및 3D 그래픽 기술의 발전과 함께 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 주요 그래픽 칩셋 업체들과의 전략적 관계강화를 통하여 데스크탑, 노트북용, HPC용 등 PC 그래픽 및 기존 게임 외에 의료, 교육, 네트워크 커뮤니케이션 등 분야로 활용 영역을 넓히고 있는 차세대 게임콘솔 분야에서도 주도적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

컨슈머 메모리(Consumer Memory) 시장은 스마트 디지털TV, 디지털 셋톱박스(Set-top Box), 블루레이 플레이어(Blu-ray player) 등의 디지털 영상 가전제품, 프린터를 포함한 PC주변기기, 자동차용 네비게이션 제품 등에 다양하게 사용됩니다. 또 당사는 클라우드 컴퓨팅 확대에 따른 네트워크 인프라 장비에 맞는 고용량, 고속의 첨단 컨슈머 메모리를 개발하여 경쟁력 있는 제품을 시장에 공급하고 있으며, 고온 및 저온에도 견딜 수 있는 극한 환경에 특성화된 IT(Industrial Temperature) 제품과 AT(Automotive Temperature) 제품을 개발, 공급하는 등 고객의 다양한 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 휴대전화뿐만 아니라 모바일 특성에 연산 기능이 향상된 태블릿PC, 울트라 북에도 사용되고 있으며, 디지털 카메라, 네비게이션, MP3 플레이어 등과 같은 모바일 컨슈머 제품등에도 채용이 확대되고 있습니다. 라이프 스타일 변화에 따른 IT 수요 증가 및 무선 통신 환경의 발전, 정보통신 융합(Convergence)의 가속화로 현재 가장 성장성이 높은 제품입니다. 이 중에서도 저전력/고성능/대용량 메모리를 필요로 하는 스마트폰 및 태블릿PC의 보급률 증가 추세는 향후에도 모바일 메모리 제품의 수요를 강하게 견인할 것으로 예상됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하였습니다. 낸드플래시 시장이 이렇게 성장을 지속하는 이유는 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서 낸드플래시 채용률이 지속적으로 높아지고 있기 때문입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대에 따른 채용량 증가로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 스마트TV, 스마트카 등의 신 개념 도입으로 인하여 과거에 저용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 분야에서도 고용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근에는 SSD(Solid State Drive)와 같은 낸드플래시를 기반으로 한 다양한 형태의 Storage Solution이 노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은 낸드플래시 시장에서 당사는 저용량부터 고용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용분야별 선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한 높은 기술력을 바탕으로 Floating Gate 방식의 10nm대 Planar NAND 및 3D NAND를 개발, 빠른 NAND 시장 변화에 발 맞추어 대응하고 있습니다.

(나) 비메모리반도체 사업

회사는 지난 2007년 11월, 제품 포트폴리오를 더욱 다양화하고, 기존 메모리 사업 역량을 활용하여 안정적인 수익성과 높은 투자효율성이 기대되는 CIS 사업에 재진출하였습니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

CIS는 휴대 전화, 디지털 카메라, 노트북, 태블릿 PC, 웹캠 등 다양한 디지털 기기에서 촬영 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2011~2016년까지 약 15%의 연평균 성장률이 예상되는 시장입니다. (출처: Techno-

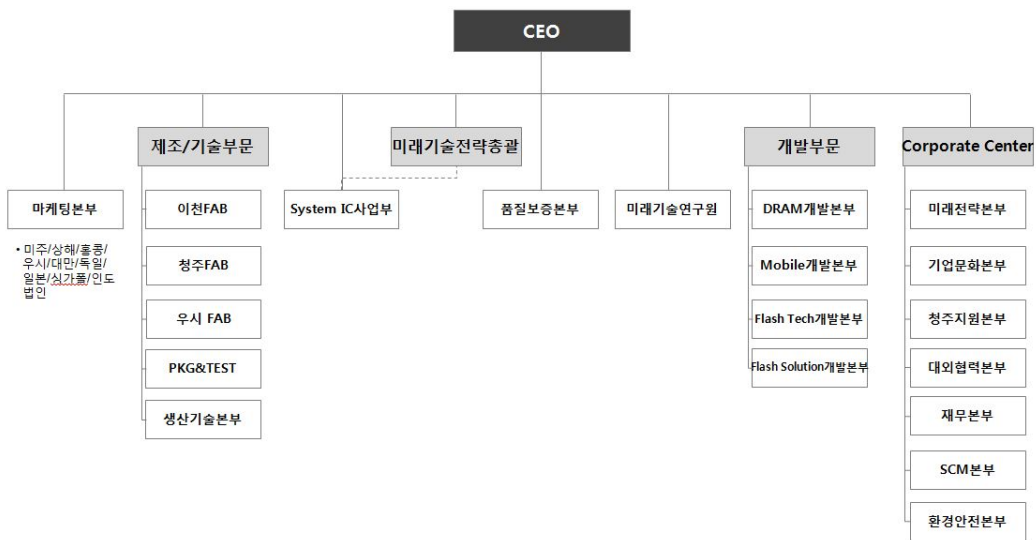
현재는 휴대 전화와 노트북, 태블릿 PC에 가장 많이 쓰이고 있으나 주변 회로가 필요 없고 전력 소모가 적은 장점과 함께 최근 기술의 발전으로 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR 및 캠코더, 자동차, 보안장비, 게임기, 가전 제품 등으로 응용 범위가 급속히 확대되고 있습니다. 또한 최근 카메라사진 촬영과화상 통화를 위해 두 개의 이미지 센서가 휴대전화에 장착되고 있으며, 이러한 경향은 태블릿PC에도 반영되어 기기당 이미지 센서 탑재 비율 역시 늘어나는 추세입니다.

현재 당사의 CIS는 센서 중 가장 많은 수량 비중을 점유하고 있는 휴대전화 응용시장과 이와 유사한 센서 특징을 요구하고 있는 노트북 시장, 그리고 최근 급속한 성장세를 보이고 있는 태블릿PC와 Toy 시장에 집중하고 있으며, 유사 응용시장으로의 확대를 통해 신규 시장 및 지역, 고객을 발굴하여 사업의 안정성 강화와 수익성을 개선하고 있습니다. 또한 새로운 시장 및 고객 창출을 위해 새로운 IP개발과 신기술 확보를 통해 기술 및 가격 경쟁력을 보유한 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

2013년에는 BSI(Back-Side Illumination) 기술을 적용한 8M, FHD, HD 제품의 시장 확대를 통하여 자사제품 확대의 견인차 역할을 하였으며, 2014년은 최초로 13M 개발 진행 중에 있어 한층 더 제고된 기술력을 통해 시장의 브랜드 이미지 강화에 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

당사는 한층 강화된 사업 역량을 바탕으로 국내와 중국, 대만 지역뿐만 아니라 향후 미구주 지역의 고객 확대와 어플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도(제출일 기준)



다. 사업부문별 재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, MCP 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	3,742,690(100%)
합계					3,742,690(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

DRAM 가격은 2013년 우호적인 수급환경에 힘입어 전년 대비 큰 폭 상승하였고, 2014년 1분기에도 재고 확보를 위한 PC OEM들의 수요 증가 등으로 안정적 가격 환경이 유지되었습니다. 반면 NAND 가격은 2013년 하반기부터 지속적으로 하락세를 보였고, 2014년 1분기에도 모바일형 제품의 계절적 수요 약세에 따른 가격 약세가 지속되었습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 셉스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

리드프레임은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

셉스트레이트는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땜하여 회로기능을 완성시키는 인쇄 배선판입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비 고
------	------	-----	-------	-----	----	-----

반도체 부문	원재료	Wafer	F A B	104,972	14	-
		Lead Frame& Substrate	P K G	34,264	5	-
		PCB	M O D	31,068	4	-
		기타		289,915	39	-
		소계		460,218	62	-
	저장품	S/P , 부재료		280,295	38	-
	합 계			740,514	100	-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본의 2개사, 독일의 1개사, 한국 1개사, 미국 1개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입 하고 있습니다. 당사는 당사와 거래하는 매입처 등과 일상적인 영업 활동 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

웨이퍼는 그 원재료가 되는 폴리 실리콘의 수급 동향에 따라 300mm 웨이퍼 완제품 가격이 큰 영향을 받습니다. 특히, 폴리 실리콘은 웨이퍼 이외에도 태양전지(Solar Cell)의 원료로도 사용되기 때문에 태양전지의 수요에 따라 폴리 실리콘의 일시적 부족현상이 발생하면 웨이퍼의 공급에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서, 당사는 주요 원재료인 웨이퍼의 원활한 확보를 위해 유가 및 폴리 실리콘 시장의 가격동향은 물론, 동일한 원재료를 사용하는 태양전지 수급동향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 국내사업장 기준 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2014년 1분기 총 가동일은 90일로, 각 지역별 팹(Fab)의 가동인원 및 수율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동 시간은 월 11,633,040시간입니다.

생산능력은 "해당 분기까지의 최대생산일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2014년 1분기 생산능력은 2,433,533백만원 입니다

(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	제67기 1분기	제66기 연간	제65기 연간
반도체 부문	2,433,533	9,685,779	9,942,732

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사의 2014년 1분기 생산실적은 2,433,533백만원으로 집계되었으며, 동 기간 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제67기 1분기	제66기 연간	제65기 연간
반도체 부문	2,433,533	9,685,779	9,942,732

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
반도체 부문	34,899,120	34,899,120	100%

※가동률은 각 지역별 팹(Fab)의 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함.

다. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 12조 8천 546억원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2014.1.1								
취득원가	504,398	1,853,862	533,776	32,215,475	2,573	758,538	687,203	36,555,825
감가상각누계액		△519,184	△305,041	△22,606,719	△2,345	△546,595		△23,979,885
손상차손누계액		△24,862	△21,436	△378,358		△2,832	△10,632	△438,120
정부보조금				△8,023				△8,023
기초순장부금액	504,398	1,309,816	207,299	9,222,376	228	209,111	676,571	12,129,797
기중변동액								
취득				7,192	52	1,388	1,575,394	1,584,026
처분		△756	△10	△26,881		△202	△351	△28,200
손상차손		△23,620	△1,777	△521				△25,918
감가상각누계액		△13,011	△4,555	△740,117	△35	△16,593		△774,311
대체		14,840	10,395	1,037,599	19	18,824	△1,080,289	1,389
환율변동 등	141	△1,892	△1,110	△26,301	1	△172	△2,837	△32,170
분기말순장부금액	504,538	1,285,377	210,243	9,473,347	265	212,356	1,168,488	12,854,615
2014.3.31								
취득원가	504,538	1,866,054	543,051	33,207,085	2,645	778,376	1,179,120	38,080,870
감가상각누계액		△532,195	△309,597	△23,346,836	△2,379	△563,188		△24,754,195
손상차손누계액		△48,482	△23,212	△378,879		△2,832	△10,632	△464,037
정부보조금				△8,023				△8,023

분기말순장부금액	504,538	1,285,377	210,243	9,473,347	265	212,356	1,168,488	12,854,615
----------	---------	-----------	---------	-----------	-----	---------	-----------	------------

라. 투자계획

2014년 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액 (제67기 누적)	비 고
보완투자	기계장치 외	생산능력증가	2014.01.01~ 2014.03.31	1,419	-
합 계				1,419	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제67기 1분기	제66기	제65기
반도체 부문	제품 외	DRAM, 낸드플래시, MCP 등	3,742,690	14,165,102	10,162,210
합 계			3,742,690	14,165,102	10,162,210

※ 매출실적은 연결기준입니다.

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

국내에서는 마케팅 본부 내 국내영업팀 관할 하에 대리점 6개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매 법인은 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국 등에 10개법인이 소재하고 있으며 산하에 16개의 사무소 및 18개 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 거래하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 조건 등으로 거래하고 있

습니다.

(4) 판매전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝 유지' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 서버, 그래픽, 모바일, 컨수머 등 응용분야의 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다.

수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래시장 발굴을 추진하고 있습니다.

고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다.

지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

반도체의 경우 IT 컨수머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 DELL, HP 등 세계 유수의 PC 및 서버 등 Computing 관련 전자 업체와 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등에 제품을 공급하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기 공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외 사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	3,211	3,431,593	3,823	4,085,820

EUR	4	6,114	184	269,864
JPY	2,708	28,132	42,033	436,609
기타	1	773	-	281
합 계	5,924	3,466,612	46,040	4,792,574

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	(65,423)	65,423
EUR	(26,375)	26,375
JPY	(40,848)	40,848
기타	49	(49)
합 계	(132,597)	132,597

(2) 가격위험

연결실체는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품은 35,471백만원입니다.

(3) 이자율 위험

연결실체의 현금흐름 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결실체는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결실체는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자수익과 이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 3,647백만원 만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다.

나. 회사의 위험관리 정책

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정을 제정하고 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다.

(1) 위험관리의 일반적 전략

[위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있으며, 그주요 내용은 ①외 환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실 수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 외환관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하고 있습니다.

[파생상품계약 운용]

당사는 파생상품계약을 환위험 헤지 목적으로 운용하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 설치·운영하고 있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
- ② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
- ③ 환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
- ④ 환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
- ⑤ 환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

다. 위험관리 관련 추진사항

당사는 영업상의 환율 변동 영향을 축소하기 위해 파생상품 거래를 체결하고 있습니다. 파생상품 거래를 매매목적의 거래로 분류하여 회계처리 하고 있으며, 발생한 손익은 기업회계기준에 따라 당기 손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

8. 파생상품 거래현황

연결실체는 이자 및 원금스왑, 선물환 매도계약, 이자율 스왑, 통화옵션계약 등을통하여 환율변동위험, 현금흐름 이자율위험 등을 관리하고 있습니다. 또한 내재파생상품인 해외전환사채에 내재되어 있는 전환권옵션을 분리하여 공정가치로 평가하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 기타금융자산으로 계상되어 있는 파생금융자산은 157백만원(전기말: 272백만원)이며 기타금융부채로 계상되어 있는 파생금융부채는 91,534백만원(전기말:109,288백만원)임

니다.

당분기에 파생상품거래와 관련하여 인식한 평가이익 및 거래이익은 16,149백만원(전분기: 1,124백만원)이며 평가손실 및 거래손실은 352백만원(전분기: 28,255백만원)입니다.

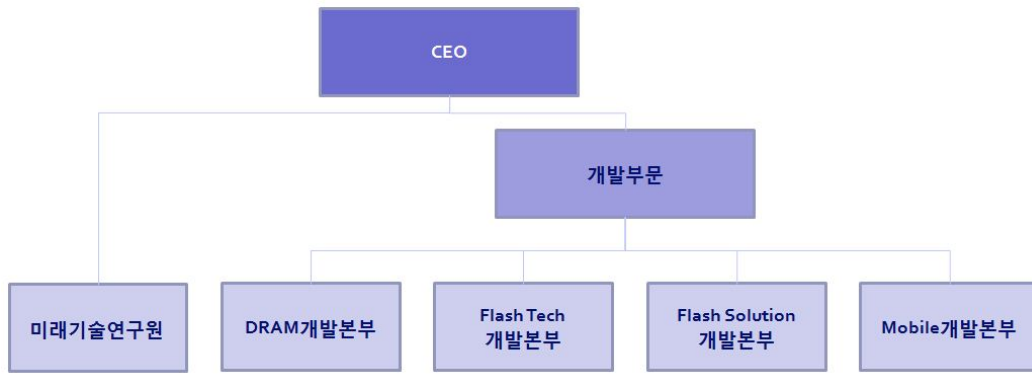
9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항목	내용	비고
삼성전자	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	
	계약 기간	2013년 6월 1일~	
	목적 및 내용	삼성전자가 보유하고있는 반도체 관련 모든 특허에 대한 사용권을 확보하여 향후 잠재적 분쟁 가능성 원천적 해소	
	기타 주요내용	-	
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	
	계약 기간	2013년 7월 1일~2018년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하	
실리콘화일	계약 유형	주식교환계약	
	계약 기간	2014년 1월 28일~	계약 체결일
	목적 및 내용	주식의 포괄적 교환을 통해 실리콘화일을 완전자회사로 편입하여 CIS 사업의 경영 효율성 증대	
	기타 주요내용	주식교환일: 2014년 4월 22일 주식교환비율: 에스케이하이닉스 보통주 : 실리콘화일 보통주 = 1 : 0.2232438	

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 미래기술연구원과 개발부문(DRAM개발본부, FlashTech개발본부, Flash Solution개발본부, Mobile개발본부)에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제67기 1분기	제66기	제65기	비 고
원 재 료 비		12,700	44,940	42,571	-
인 건 비		117,934	440,289	335,212	-
감 가 상 각 비		36,097	129,047	132,448	-
위 탁 용 역 비		34,299	101,378	43,117	-
기 타		106,002	428,824	384,933	-
연구개발비용 계		307,032	1,144,477	938,281	-
회계처리	판매비와 관리비	272,304	954,206	807,704	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	34,728	190,271	130,577	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100]		8.2%	8.1%	9.2%	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

구 분	연구과제명	기대효과
제67기 1분기	1) 20나노급 Enterprise향 SSD	자체 개발한 Amber 컨트롤러 및 FW를 채용한 자사 최초 20나노급 Enterprise향 SSD 제품으로, Power Loss Protection 기능을 탑재하여 순간적으로 전원이 차단되어도 모든 데이터를 안전하게 보호할 수 있으며, 어떠한 환경에서도 지속적인 성능 및 Latency를 유지하도록 하여 서버 시스템에 최적화 되어 있음. 향후 지속적인 성장이 예상되는 데이터 센터에 사용하는 솔루션으로 자사 SSD 사업 확대를 통한 매출 및 수익성 확보에 기여할 것으로 기대됨.
	2) 4G LPDDR2	모바일 2y나노 기술로 개발된 제품으로서 2x나노 Tech 모바일 DRAM이 사용되고 있는 시장의 Tech migration을 통한 Low

		cost 전략 제품임. 기존 대비 Net die 70% 증가로 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	3)5M 1/4"(90nm, 1.40um pixel, FSI)	중국 시장에서 판매되고 있는 기존 제품 대비 수익성 증대를 위해 Net die를 11% 증가시킨 제품으로 원가 절감을 통한 제품 경쟁력 향상으로 매출과 수익성 확대에 기여할 것으로 보임.
	4)5M 1/4"(90nm, 1.40um pixel, BSI)	중국 및 한국 시장의 중저가 스마트폰향으로 전면 및 후면카메라에 5M 제품의 채용이 확대되고 있어 중저가폰의 고화질 제품으로의 판매 확대가 예상됨

구 분	연구과제명	기대효과
제66기	1) 4Gb GDDR5	GDDR5 제품중 20나노 공정 기술을 적용한 첫 고용량 제품으로서 그래픽 시장의 프레임 버퍼(Frame Buffer) Size 증가 요구를 반영한 제품임. 저전력 고성능 구현으로 그래픽 시장을 리드할 것으로 기대되는 프리미엄 제품으로, 하이브리드 설계구조 적용으로 원가 경쟁력을 위한 와이어 본딩/8Gbps 솔루션으로 Flip Chip 동시 지원 가능.
	2) 32/64/128/256GB mSATA SSD	지난해 인수한 SKHMS와의 시너지를 통한 첫 자체 20나노 SSD(mSATA) 제품으로 기존 26nm SSD 제품 대비 우수한 성능과 원가 경쟁력을 가지고 있음. OEM향 노트북, 태블릿 시장에서 다양한 고객 요구에 대응할 수 있는 제품을 확보함에 따라 매출과 수익성 확대에 크게 기여할 것으로 기대됨.
	3) 4/16/32/64GB e-NAND(eMMC4.5)	2Y나노 eMMC4.5 제품으로 기존 2Ynm eMMC4.41 제품 대비 2배 이상 향상된 성능을 통해 Ci-MCP와 고용량 eMMC 제품의 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
	4) 2M 1/5"(130nm, 1.75um pixel, Hi-257)	중국 시장에서 저가형 스마트폰의 메인 카메라로 2M 제품 채용이 확대되고 있는 시점에서 Net Die를 기존 제품 대비 40% 증가시킨 제품으로서 당사의 시장점유율을 확고히 하는데 기여할 것으로 기대됨.
	5) 4Gb DDR4	20나노급 공정 기술을 적용한 세계 최초의 DDR4 양산 제품으로 인텔 하스웰(Haswell) 시스템 개발 초기부터 참여하여 PMO(Platform Memory Organization) 샘플 대응을 통해 시스템과 모듈간 Align을 진행. 자사 최초로 인텔 CDC(Columbia Design Center) FlugFest에 참석하여 Green Light 획득. DDR4 시장의 선도적 진입 및 리더십 확보를 위한 교두보를 마련하였음.
	6) 2Gb GDDR5	20나노급 공정 기술을 적용한 제품으로 기존 30나노급 대비생산성 향상에 기여. 기존 제품 대비 퍼포먼스(저전력 및 고속 동작 지원)가 향상되어 그래픽 메모리 시장을 선도하며, 2Gb 제품의 주력 생산이 될 제품. High-end PC향 그래픽 및 서버 등에도 채용을 추진중으로 신규 시장 창출이 기대됨.
	7) 2Gb SLC NAND	30나노급 기술을 적용한 4bit ECC 지원 제품으로 모바일향으로 개발되었으며, 기존 40nm급 대비 생산성이 29% 향상됨. 공정 미세화를 통한 수율과 품질을 확보하여 가격 경쟁력 확보 및 수익성 향상이 예상되며, 당사의 시장점유율을 높이는데 기여할 것으로 기대됨.
	8) 64Gb MLC NAND	세계 최초 1X나노 공정을 적용한 핵심제품으로서 기존 고용량

	20nm 64Gb 제품 대비 생산성이 크게 향상되어 원가 경쟁력을 확보하였으며, 최근 크게 수요가 증가되고 있는 모바일용 eMMC 및 PPN, 스토리지용 SSD 등 솔루션 제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
9) 64/128/256/512GB STD2.5" SSD, 64/128/256GB M.2 SSD	자체 개발한 컨트롤러를 채용한 2Y나노 2.5인치 스탠다드SSD 및 M.2 SSD 제품으로 기존 2Ynm SSD 제품 대비 우수한 성능과 원가 경쟁력을 확보함으로써 향후 높은 성장성과수익성이 예상되는 PC OEM 시장 집중 및 고객 다변화로 SSD 매출 및 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
10) 4Gb LPDDR3	모바일 2X나노 기술로 개발된 제품으로 모바일 기기의 High performance 요구와 울트라북의 Low Power 제품 채용에 따른 모바일 DRAM 매출 확대에 기여할 것으로 예상됨.
11) 1Gb/512Mb DDR2	4X나노에서 2X나노로 Tech Migration한 컨수머용 DDR2 제품으로 nVIDIA社 Automotive용 Biz 진입을 통해 지속적으로수익을 창출하는 제품으로 자리잡을 것으로 기대됨. 또한 Half Chip 설계 기술 적용으로 512Mb Density 시장에 대해서도 전략적 대응이 가능.
12) 8Gb LPDDR3	모바일 2Y나노 기술로 세계 최초 개발된 8Gb LPDDR3 제품으로 최근 요구되고 있는 모바일 기기의 High Performance 와 저전력 특성을 확보하였으며, 두께에 민감한 제품 수요에 대응할 수 있어 모바일 DRAM 매출 확대에 기여할 것으로 예상됨.
13) 16/32/64GB e-NAND(eMMC4.5)	1X나노 Tech의 NAND 제품을 적용한 모바일 솔루션 제품으로 기존 2Ynm eMMC4.5 제품 대비 원가 경쟁력을 확보하였으며, Small PKG 고용량 제품 라인업 완성으로 자사 모바일 제품 경쟁력을 확보하여 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
14) 128,256GB M.2 2260 SSD	자사 2Y나노 Tech NAND를 적용한 울트라북용 SSD 제품으로 차세대 Formfactor를 지원함으로써 신규 시장의 주요 OEM 고객 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.
15) 4Gb DDR3	Main Memory 2y나노급 세계 최소 Cell Size 제품 개발로 원가 경쟁력 확보하였으며 R/H Free 대응으로 품질 경쟁력 확보 및 고용량 제품에 대한 지속적인 수요 대응으로 PC 및Server시장 매출 확대에 기여 할 것으로 예상.
16) 1G LPDDR2	Modem 통신 방식이 3G에서 LTE로 진화함에 따라 LPDDR1에서 LPDDR2 Migration이 발생하고, 이에 대한 SOC 업체의 SIP 대응을 위한 KGD 제품 개발로 매출 향상에 기여할 것으로 예상.
17)6G LPDDR3	PKG Height로 인해 8G LPDDR3로 대응이 불가능한 3GB Solution 대응을 위해 개발 추진. Time to Market을 위해 개발 기간 단축 달성 및 세계 최초 6Gb LPDDR3 개발. 자사의 개발 역량 표출 및 3GB Solution에서 시장선점과 매출 향상에 기여할 것으로 예상.
18) 64G MLC B-die	세계 최소의 1x나노 공정을 적용한 핵심제품으로써 기존 1x나노 64G MLC 대비 Net Die 개선을 통해 원가 경쟁력 향상에 기여하였으며, 이를 통해 최근 크게 수요가 증가되고 있는

		Mobile향 eMMC 및 PPN과 Storage향 SSD 등 Solution제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
	19) 128G MLC	세계 최소의 1x나노 공정이 적용된 자사 최초 128G High Density 제품임. SSD 적용 시 적층을 통해 1TB까지 지원이 가능하여 대용량 Storage 시장 공략을 위한 NAND Line Up을 구축.
	20) 32G MLC	기존 2x나노 32G MLC 대비 세계 최소 1xnm 공정 적용을 통한 Net Die 개선으로 원가 경쟁력 향상을 이끌어내었으며, 이를 통하여 eMMC 및 CiMCP에 적용되어 제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
	21) 8/16/32GB e-NAND(eMMC5.0)	차세대 고성능 eMMC 인터페이스 규격을 지원하는 1x나노 eMMC5.0 제품 출시를 통해 eMMC 시장에서 원가 및 성능 경쟁력을 확보하였으며, 기존 OEM 고객 외에도 중국 등의 신규 고객 확보를 통한 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
	22) 32/64GB M.2 2242 SSD	2x나노 Tech NAND와 Amber Controller를 적용하여 만든 Cache 용 SSD 제품으로 인텔의 차세대 SSD 규격인 M.2 2242를 지원하고, 최근 Trend인 Dual Driver(SSD Cache+HDD Main Storage) Ultrabook 시장 진입을 통해 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.
	23) 2M 1/5"(130nm, 1.75um pixel)	2M MIPI I/F를 지원하는 Hi-256의 수익성을 개선한 제품으로 중국향 Low-cost 버전인 Hi-257을 기반으로 MIPI I/F를 추가하여 Net die를 Hi-256 대비 증가시켜 수익성 개선에 크게 기여함과 동시에 중국 시장의 MIPI I/F 채용 확대로 시장 점유율 확대에도 기여할 것으로 보임.
	24) 1.7M 1/6"(90nm, 1.75um pixel)	이미지 센싱 기능 외에 근접센서/조도센서/Motion detection/Face Recognition 등의 부가 기능을 one-chip화 함으로써 부가 가치를 창출하고 틈새 시장에 진출하여 매출에 기여할 것으로 기대됨.
	25) 8M 1/4"(90nm, 1.12um BSI pixel)	BSI 1.12um Pixel을 적용한 첫 제품으로 모바일폰에서 가장 많은 점유율과 성장률이 예상되는 8M 제품 개발을 완료함으로써 향후 CIS 매출에 많은 기여를 할 것으로 기대됨.

구 분	연구과제명	기대효과
제65기	1) 64Gb MLC NAND	2Y나노 공정을 적용한 핵심제품으로써 기존의 고용량 2X나노 64Gb 제품 대비 생산성이 40% 이상 향상되어 원가 경쟁력을 확보하였으며, 최근 크게 수요가 증가하고 있는 모바일향 솔루션 제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
	2) 4Gb LPDDR3	30나노급 기술을 적용한 LPDDR3 제품으로 기 양산중인 LPDDR2 제품 대비 고속 및 저전력 동작이 가능함. PC에 채용되는 DDR3 제품의 속도를 구현할 수 있어 저전력 고속 동작을 요구하는 고사양 스마트폰 및 태블릿 PC에 채용될 예정임.
	3) 1Gb DDR3(x16)	30나노급 기술을 적용한 컨수머 제품으로, 컨수머 어플리케이션에서의 Long Term Supportability를 확보하기 위한 제품임. 자사 최초로 Array E-Fuse 기술이 적용된 제품으로 향후 모든 DRAM에 적용 가능한 Array E-Fuse 설계 요소 기술을 확보하

		여 상용화를 달성하였으며, Cost Effective Test Baseline 구축 가능 효과가 있을 것으로 기대됨.
4) 2Gb DDR3		20나노급 공정을 적용한 DRAM 핵심제품으로 기존 30나노급 제품 대비 생산성이 크게 향상되어 원가 경쟁력을 확보하였으며, 설계 및 소자 기술의 혁신으로 저전력, 초고속 특성이 확보되어 수익성 향상에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.
5) 32Gb MLC NAND		20나노급 공정을 적용한 eMMC형 제품으로 모바일 기기의 Small PKG 대응을 통해 제품 경쟁력을 확보하여 모바일용 솔루션 제품 수익성 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨.
6) 16Gb MLC NAND		20나노급 공정을 적용한 저용량 eMMC 및 USD형 제품으로 모바일 기기의 저용량 제품 대응을 통해 20나노급 제품 포트폴리오를 강화하여 모바일용 솔루션 제품 수익성 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨.
7) 4Gb SLC NAND		30나노급 SLC 제품으로 기존 40나노급 제품 대비 생산성이 크게 향상되어 Mid/Lowend Smartphone용 MCP 제품 경쟁력 확보 및 모바일 제품 수익성 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨.
8) 4/8/16/32GB e-NAND(eMMC4.41)		20나노급 NAND를 사용 기존 20나노급 제품 대비 높은 성능과 원가 경쟁력을 확보하여 고성능 대용량의 스마트폰과 태블릿 PC등의 모바일 시장에서 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.
9) 64/128/256GB STD2.5 " SSD		20나노급 NAND를 사용하여 만든 SSD(SATA 6.0Gbps) 제품으로 자사 브랜드로는 최초의 사용화 제품임. 최근 급성장하는 데스크탑, 노트북등의 SSD 시장에서 고부가가치의 NAND 솔루션 제품으로 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
10) 32/64/128GB mSATA SSD		20나노급 NAND를 사용한 mSATA 규격(SATA 6.0Gbps)의 제품으로 최근 급성장하는 울트라북 OEM용 SSD 시장에서 제품 경쟁력을 확보하여 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.
11) 1Gb CDR(x512)		소니사의 고객 System 개발과 연계하여 Biz를 이어나갈 제품으로 개발 되었으며 자사 최초로 Multi-Channel Wide IO(x512) DRAM을 개발하였고, 향후 모바일 플랫폼의 주요 기술인 Wide IO TSV기술 개발에 기여할 것으로 기대됨.
12) 4Gb DDR3		2012년까지 주력 제품이 될 High Density 제품으로 30나노급에 이어 원가 및 퍼포먼스 측면에서 경쟁력 있는 20나노급을 개발함으로써 수익성 향상에 기여할 것으로 기대되며, 특히 온도에 따라 대기전류를 효율적으로 제어하는 기술을 통해 저전력 시장요구에 부합하는 제품으로 향후 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대됨.
13) 2GB e-NAND(eMMC4.41)		20나노 Base Emmc4.41 제품 확보로 Low Density 제품 라인업에도 경쟁력을 확보 함. 향후 컨수머용 Low Density 제품에 진입기회를 확보 할 수 있음.
14) 4Gb LPDDR2		20나노급 모바일 DRAM 기술을 적용하여 개발된 제품으로 최근 스마트폰 시장에서 수요가 급증하고 있어 기존 30나노급 제품 대비 수익성 향상에 기여할 수 있을 것으로 예상됨.

15) 2M MIPI CSP, 1.75um, 130nm	기 양산중인 Hi-255 제품을 기반으로 CSP 패키지가 가능하도록 개발된 제품으로 향후 중국 시장 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.
16) 2Gb DDR3(x16)	그래픽&컨수머 시장의 주력 제품으로 30나노급 이후 20나노급 개발을 통해 수익성 향상에 기여한 제품으로, 특히 빠른 속도 (1Ghz) 및 저전력(1.35V) 특성확보를 통해 그래픽&컨수머 시장의 리더쉽을 유지하는데 기여할 것으로 기대됨.
17) 60/120GB STD 2.5" SSD	20나노급 NAND 및 새로운 컨트롤러를 적용한 2.5" 스탠다드 (SATA 6.0Gbps) SSD 개발로 기존제품 대비 높은 성능과 안정성을 제공할 것으로 예상됨.
18) 2Gb LPDDR	30나노급 모바일 DRAM 기술을 적용하여 개발된 제품으로 중국향 저가 스마트폰에 채용되는 기존 40나노급 제품 대비수익성 향상에 기여할 수 있을 것으로 예상됨.

11. 기타 투자이사결정에 필요한 사항

가. 최근 3년간 신용등급 [국내]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등 급범위	평가구분
11.01.05	회사채(210)	BBB+	NICE신평	AAA ~ D	본평가
11.01.05	회사채(210)	BBB+	한기평	AAA ~ D	본평가
11.01.05	회사채(210)	BBB+	한신평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	한기평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	한신평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	한기평	AAA ~ D	정기평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	한신평	AAA ~ D	정기평가
11.11.15	회사채(수시평가)	A-	한신평	AAA ~ D	수시평가
11.11.16	회사채(수시평가)	A-	한기평	AAA ~ D	수시평가
12.02.16	회사채(수시평가)	A	NICE신평	AAA ~ D	수시평가
12.02.17	회사채(수시평가)	A	한기평	AAA ~ D	수시평가
12.02.17	회사채(수시평가)	A	한신평	AAA ~ D	수시평가
12.05.24	회사채(정기평가)	A	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
12.05.24	회사채(정기평가)	A	한기평	AAA ~ D	정기평가
12.05.24	회사채(정기평가)	A	한신평	AAA ~ D	정기평가
12.05.24	회사채(212)	A	한신평	AAA ~ D	본평가
12.05.24	기업어음(본평가)	A2	NICE신평	A1~D	본평가

12.05.24	기업어음(본평가)	A2	한기평	A1~D	본평가
12.05.24	기업어음(본평가)	A2	한신평	A1~D	본평가
12.08.22	회사채(213)	A	NICE신평	AAA ~ D	본평가
12.08.22	회사채(213)	A	한기평	AAA ~ D	본평가
12.08.22	회사채(213)	A	한신평	AAA ~ D	본평가
12.12.24	기업어음(정기평가)	A2	NICE신평	A1~D	정기평가
12.12.24	기업어음(정기평가)	A2	한기평	A1~D	정기평가
12.12.27	기업어음(정기평가)	A2	한신평	A1~D	정기평가
13.06.20	회사채(정기평가)	A+	한기평	AAA ~ D	정기평가
13.06.20	회사채(정기평가)	A+	한신평	AAA ~ D	정기평가
13.06.27	회사채(정기평가)	A+	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
13.06.20	기업어음(본평가)	A2+	한기평	A1~D	본평가
13.06.20	기업어음(본평가)	A2+	한신평	A1~D	본평가
13.06.27	기업어음(본평가)	A2+	NICE신평	A1~D	본평가

[해외]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등 급범위	평가구분
12.02.14	해외사채	BB-	S & P	AAA ~ D	수시평가
12.02.15	발행회사	Ba3	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
13.02.22	발행회사	BB	S & P	AAA ~ D	수시평가
13.08.20	발행회사	Ba2	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
13.12.05	발행회사	BB+	S & P	AAA ~ D	수시평가

※ 상기 S&P 및 Moody's의 본점 소재지는 미국임.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급	등급의 정의
A1	적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B	적기상환능력이 걱정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D	상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급	등급의 정의
Aaa	최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.
Aa	신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.
A	중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.
Baa	신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.
Ba	투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.
B	투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.
Caa	신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.
Ca	투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.
C	채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급	등급의 정의
------	--------

AAA	채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.
AA	채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.
A	채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BB	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨
B	현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.
CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.
CC	채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.
D	채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

나. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있습니다. 당사의 S/A 고객은 본 보고서 작성일 현재 총 15개사로 각 응용 분야별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

다. 지식재산권 보유현황

2014년 03월 31일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 14,160건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

특허권, 실용신안권 및 상표권은 각국의 특허법, 실용신안법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년(실용신안은 10년), 상표는 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 총 60인으로 구성된 전담조직에서 출원, 등록 및 사후관리, 분쟁대응등을 담당하고 있습니다. 다양한 지식재산권이 당사 제품 생산 및 사업운영에 활용되고 있으며 각각의 세부사항 및 특허권의 상세한 내용은 영업비밀에 해당되므로 기술하지 않습니다.

라. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

'산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조'에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 이태리기술센터(SKHYIT)에 낸드플래시 응용제품 설계기술 이전에

관한 사항을 관련법을 준수하여 신고 수리를 완료하였습니다.

마. 환경보호 정책 및 현황

(1) ESH경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO14001(환경경영시스템) & OHSAS18001(안전보건경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리하고 있으며, 기업활동으로 인해 발생하는 환경 및 안전보건 영향요인을 효율적으로 관리하기 위해전담조직을 구성하여 체계적으로 관리하고 있습니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유.무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[온실가스 에너지 목표관리제]

당사는 정부에서 시행하는 온실가스 에너지 목표관리제 관리업체로서 2011년부터 당사의온실가스 배출량을 측정.검증하여 보고하고 있으며, 매년 온실가스 저감 목표를 수립하여달성을 위해 노력하고 있습니다. 공정가스인 PFCs 배출 저감을 위해 대체가스 적용, PFCs 저감 장치 효율 관리를 위한 EPA 방법론 도입 및 운영, 공정 최적화, 촉매가스 활용 등 다양한 아이টে을 지속적으로 추진하고 있으며 에너지 절감 활동에서는 전사 Task Force 운영을 통해 저감 아이টে 발굴 및 이행, 저감 로드맵 수립, 운영현황 공유 등 체계적인 관리 하에 에너지 저감 활동을 강화하고 있습니다.

[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 5년 연속 선정, 명예의 전당 입성]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는탄소경영 최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초, 국내 유일 기업으로 명예의 전당에 입성하였습니다.

(3) 친환경제품을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/Eco-efficiency/탄소성적]

당사는 2010년 LCA 전산화 시스템을 구축하여 매년 DRAM 및 Nand Flash 메모리 단품 제품의 전과정평가를 확대하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 2013년 10월에는 환경부로부터 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 반도체 업계 최초로 환경성적표지 인증을 획득, 2013년 12월에는 동제품에 대해 영국 로이드인증원으로부터 국내 최초 해외탄소라벨링 인증을 획득하였습니다. 또한 회사는 2008년도부터 Eco-efficiency를 개발하여 각 제품별 환경성을 공개하고, 환경영향을 감소시키기 위한 지표로 활용하고 있습니다.

당사는 2013년 6월에 30나노급 4Gb LPDDR2 제품과 20나노급 64Gb NAND 제품에 대해 환경부로부터 각각 탄소배출량 인증과 저탄소제품 인증을 획득하였습니다. 이는 2009년 탄소성적표지 최초 인증 이후 일곱 번째로 받은 인증으로 회사는 앞으로도 주요 DRAM 및Nand Flash 제품에 대해 지속적으로 탄소성적표지 인증을 획득할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하고 그 결과를 환경경영검증위원회 보고서로 발행하였습니다.

2013년 6월부터는 매 분기 환경경영자문회를 개최하여, 외부 자문위원으로부터 당사의 환경경영 및 환경전략에 관한 전반적인 의견을 수렴하여 보다 투명하고 건전한 환경경영활동을 전개하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약 연결재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제67기 1분기	제66기	제65기
[유동자산]	7,154,389	6,653,124	5,313,573
· 현금및현금성자산	319,961	631,867	658,387
· 단기금융상품	2,818,066	2,154,532	1,126,229
· 매출채권	2,324,972	1,941,675	1,719,521
· 재고자산	1,261,807	1,178,300	1,509,331
· 기타	429,583	746,750	300,105
[비유동자산]	14,911,350	14,144,174	13,335,120
· 관계기업 및 조인트벤처투자	108,630	107,097	104,100
· 매도가능금융자산	162,052	158,770	44,297
· 유형자산	12,854,615	12,129,797	11,586,192
· 무형자산	1,124,984	1,110,403	983,630
· 기타	661,069	638,107	616,901
자산총계	22,065,739	20,797,298	18,648,693
[유동부채]	3,964,668	3,078,239	4,441,180
[비유동부채]	4,248,695	4,652,200	4,468,071
부채총계	8,213,363	7,730,439	8,909,251
[지배기업 소유주지분]	13,853,030	13,067,243	9,740,156
· 자본금	3,568,645	3,568,645	3,488,419
· 자본잉여금	3,406,083	3,406,083	3,053,874
· 기타포괄손익누계액	△125,534	△108,807	△115,402
· 기타자본항목	-	-	-
· 이익잉여금	7,003,836	6,201,322	3,313,265
[비지배지분]	△654	△384	△714
자본총계	13,852,376	13,066,859	9,739,442
매출액	3,742,690	14,165,102	10,162,210
영업이익	1,057,266	3,379,785	△227,349
연결총당기순이익	802,254	2,872,857	△158,795
지배기업의 소유주지분	802,538	2,872,470	△158,886
비지배지분	△284	387	91
기본주당순이익	1,130원	4,045 원	△233원

연결에 포함된 회사수	22개사	22개사	20개사
-------------	------	------	------

[△는 부(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제67기의 연결재무상태표에 해당하는 부분은 2014년 03월 31일 기준이며, 연결포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2014년 03월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표 이용상의 유의점

가. 감사 의견

회사는 회계처리기준 및 연결재무제표준칙에 따라 회계처리하고 있으며, 회사가 작성한 연결재무제표에 대한 감사의견은 다음과 같습니다.

구분	제67기 1분기 (2014.01.01~ 2014.03.31)	제66기 (2013.01.01~ 2013.12.31)	제65기 (2012.01.01~ 2012.12.31)
감사인	삼정회계법인 대표이사 김 교 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태
감사의견	-	적정 의견	적정 의견

나. 연결재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책

연결실체의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2013년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.

- 기업회계기준서 제1032호 '금융상품:표시' 개정

기업회계기준서 제1032호 '금융상품:표시'의 개정에 따라 상계권리가 미래사건에 좌우되지 않고 모든 상황에서 법적으로 집행가능 해야 한다는 사실과 결제 결과가 실질적으로 차액결제와 동일한 방식으로 금액을 결제 할 수 있는 경우 차액결제 기준을 충족할 것이라는 사실을 명확히 하였습니다. 기준서의 개정은 2014년 1월 1일부터 적용되며 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

다. 연결대상회사의 변동현황

사업 연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제66기	에스케이하이이엔지(주) 등 22개사	SK APTECH Ltd. SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd. SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.(SKHYFST)	아미파워	청산
제65기	에스케이하이이엔지(주) (구. ㈜하이닉스엔지니어링) 등 20개사	Link_A_Media Devices Corp.(LAMD) SK hynix Italy S.r.l.	하이닉스인재개발원 하이로지텍 큐알티반도체	흡수합병
제64기	㈜하이닉스엔지니어링 (구. ㈜아스텍) 등 21개사	-	현대디스플레이테크놀로지, ProMOS특정금전신탕	청산

※ 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

라. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보

(단위 : 백만원)

구 분	제67기 1분기	제66기	제65기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	298,129	1,105,083	771,396
지역간내부매출액	3,492,416	13,080,509	9,513,890
계	3,790,544	14,185,591	10,285,287
2. 영업이익	1,088,123	3,224,815	△611,641
3. 자산	21,403,462	19,982,891	18,289,432
미주			
1. 매출액			

외부매출액	1,334,550	5,191,619	3,827,725
지역간내부매출액	25,540	65,448	31,222
계	1,360,090	5,257,067	3,858,947
2. 영업이익	△7,578	9,422	3,814
3. 자산	1,070,417	1,029,940	927,223
중국			
1. 매출액			
외부매출액	740,003	3,038,355	1,901,742
지역간내부매출액	503,059	2,075,362	2,736,390
계	1,243,062	5,113,717	4,638,131
2. 영업이익	△24,789	127,727	306,423
3. 자산	4,392,819	4,399,934	3,862,460
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	1,073,856	3,751,737	2,852,579
지역간내부매출액	△542	16,302	8,720
계	1,073,314	3,768,038	2,861,299
2. 영업이익	1,991	12,883	11,343
3. 자산	1,036,790	785,001	618,703
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	296,152	1,078,309	808,768
지역간내부매출액	3,895	20,676	13,404
계	300,048	1,098,985	822,172
2. 영업이익	△31	6,043	5,467
3. 자산	249,575	180,951	366,474
합계			
1. 매출액			
외부매출액	3,742,690	14,165,102	10,162,210
지역간내부매출액	4,024,368	15,258,296	12,303,626
계	7,767,058	29,423,398	22,465,836
2. 영업이익			
연결조정	△450	△1,105	57,246
계	1,057,266	3,379,785	△227,349
3. 자산			
연결조정	△6,087,325	△5,581,419	△5,415,599
계	22,065,739	20,797,297	18,648,694

[△는 부(-)의 수치임]

마. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등

(단위:백만달러)

구분	장비그룹	매각금액	적용연도	회계처리	
				별도기준	연결기준
에스케이하이닉스(주)	PROBE TEST	15	2012	담보부차입	담보부차입
에스케이하이닉스(주)	MODULE	10	2011	담보부차입	
에스케이하이닉스(주)	PKG/PKT	177	2010	담보부차입	
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	PROBE TEST	128	2009	금융리스	
		330			

3. 요약 재무정보

가. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제67기 1분기	제66기	제65기
[유동자산]	6,550,976	5,798,909	4,695,907
· 현금및현금성자산	128,722	371,204	477,747
· 단기금융상품	2,785,958	2,115,581	1,074,661
· 매출채권	2,194,949	1,803,460	1,622,659
· 재고자산	1,024,376	920,590	1,199,485
· 기타	416,971	588,074	321,355
[비유동자산]	14,767,888	14,097,350	13,507,577
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	3,358,535	3,326,243	3,259,185
· 매도가능금융자산	161,657	158,374	43,901
· 유형자산	9,846,700	9,243,030	8,944,484
· 무형자산	830,786	819,009	713,688
· 기타	570,210	550,694	546,319
자산총계	21,318,864	19,896,259	18,203,484
[유동부채]	3,352,546	2,476,997	4,240,679
[비유동부채]	3,884,955	4,216,651	4,003,162
부채총계	7,237,501	6,693,648	8,243,841
[자본금]	3,568,645	3,568,645	3,488,419
[자본잉여금]	3,444,363	3,444,363	3,092,155
[기타포괄손익누계액]	11,242	7,824	8,479

[기타자본항목]	-	-	-
[이익잉여금]	7,057,113	6,181,779	3,370,590
자본총계	14,081,363	13,202,611	9,959,643
매출액	3,716,317	13,896,309	10,001,783
영업이익	1,086,196	3,215,116	△616,285
당기순이익	875,358	2,796,967	△489,990
기본주당순이익	1,233원	3,938원	△719원

[△는 부(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제67기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2014년 03월 31일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2014년 03월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

4. 재무제표 이용상의 유의점

가. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 원가로 표시한 재무제표입니다.

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2013년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

- 기업회계기준서 제1032호 '금융상품:표시' 개정

기업회계기준서 제1032호 '금융상품:표시'의 개정에 따라 상계권리가 미래사건에 좌우되지 않고 모든 상황에서 법적으로 집행가능 해야 한다는 사실과 결제 결과가 실질적으로 차액결제와 동일한 방식으로 금액을 결제 할 수 있는 경우 차액결제 기준을 충족할것이라는 사실을 명확히 하였습니다. 기준서의 개정은 2014년 1월 1일부터 적용되며 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

가. 연결 감사인

제67기 1분기 (2014.01.01~ 2014.03.31)	제66기 (2013.01.01~ 2013.12.31)	제65기 (2012.01.01~ 2012.12.31)
삼정회계법인 대표이사 김 교 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태

나. 당해 사업연도의 연결감사절차 요약

1. 감사절차의 개요

본인은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업의 요약 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 분기연결재무제표는 2014년 3월 31일 현재의 요약 분기연결재무상태표, 2014년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약 분기연결포괄손익계산서, 요약 분기연결자본변동표 및 요약 분기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

본인의 책임은 상기 요약 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 요약 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

비교표시된 2013년 3월 31일로 종료되는 3개월 보고기간의 요약 분기연결포괄손익계산서, 요약 분기연결자본변동표 및 요약 분기연결현금흐름표는 삼일회계법인이 검토하였으며, 2013년 5월 8일자 검토보고서에는 동 요약 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았다고 표명되어 있습니다.

또한, 2013년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표는 삼일회계법인이 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2014년 2월 25일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2013년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2. 검토일정

□ 당분기 검토: 2014. 4. 7 ~ 5. 8

다. 연결 감사의견

사 업 연 도	감사의견	지적사항 등 요약
제67기 1분기	-	지적사항 없음
제66기	적정	지적사항 없음
제65기	적정	지적사항 없음

2. 회계감사인의 감사의견 등

가. 감사인

제67기 1분기 (2014.01.01~ 2014.03.31)	제66기 (2013.01.01~ 2013.12.31)	제65기 (2012.01.01~ 2012.12.31)
삼정회계법인 대표이사 김 교 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태

나. 당해 사업연도의 감사 절차 요약

1. 감사 절차의 개요

본인은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사의 요약 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 분기재무제표는 2014년 3월 31일 현재의 요약 재무상태표, 2014년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약 포괄손익계산서와 요약 자본변동표 및 요약 현금흐름표 그리고유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

본인의 책임은 상기 요약 분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 분기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 요약 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

비교표시된 2013년 3월 31일로 종료되는 3개월 보고기간의 요약 포괄손익계산서, 요약 자본변동표 및 요약 현금흐름표는 삼일회계법인이 검토하였으며, 2013년 5월 8일자 검토보고서에는 동 요약 분기재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았다고 표명되어 있습니다.

또한, 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표는 삼일회계법인이 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2014년 2월 25일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2. 검토일정

□ 당분기 검토: 2014. 4. 7 ~ 5. 8

다. 감사 의견

사업연도	감사 의견	지적사항 등 요약
제67기 1분기	-	지적사항 없음
제66기	적정	지적사항 없음
제65기	적정	지적사항 없음

라. 감사인과의 감사용역계약 체결현황

(단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내용	총소요시간	보수	비고
제67기	삼정회계법인	회계감사(별도포함)	2,050	685	
제66기	삼일회계법인	회계감사(별도포함)	11,530	695	
제65기	삼일회계법인	회계감사(별도포함)	9,000	695	

마. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	내용	수행기간	보수	비고
제66기	2013.09	계약이행 감사 자문	2013.09~12	60	-

제65기	2012.04	지분인수 재무실사	2012.04	580	-
제65기	2012.03	특정목적 감사	2012.03~12	30	-
제64기	-	-	-	-	-

3. 회계감사인의 변경

가. 변경 사유

당사는 2012년 2월 SK그룹에 편입되어 당사의 지분 20.57%를 보유하고 있는 SKT의 지분법주식 평가 대상 법인이 되었습니다.

개정된 한국회계감사기준에 따라 그룹감사인의 역할이 확대된 만큼 감사 효율성 제고를 위하여 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제4조3의 규정에 따라 2014 회계연도부터 2016 회계연도까지 당사의 외부감사인을 SKT의 외부감사인인 삼정회계법인으로 선정하였습니다.

나. 감사위원회 의결사항

2014년 2월 24일에 개최된 감사위원회에서 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조(감사인의 선임), 제4조의2(주권상장법인의 감사인 선임 등), 회사 감사위원회 규정 제14조의2(외부감사인의 선임)에 의거, '제3호 의안: 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 이에 감사위원회 감사위원 3인(김두경, 김대일, 이창양)의 만장일치로 원안대로 가결되었습니다.

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성지침에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 6인의 사외이사 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회의 2개의 소위원회가 있습니다.

(1) 이사회에 관한 내용

당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

1. 상법상의 결의사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (7) 신주의 발행
- (8) 사채의 모집
- (9) 준비금의 자본전입
- (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
- (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
- (15) 소규모 주식교환
- (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
- (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
- (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- (19) 지배인의 선임 및 해임

2. 회사 경영에 관한 중요사항

- (1) 주주총회에 부의할 의안
- (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- (3) 회사의 예산·결산
- (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신규투자 계획, 차입(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기

자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)

(5) <삭제 2012.3.5>

(6) 해외증권의 발행

(7) <삭제 1999.4.9>

(8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지

(9) <삭제 2012.3.5>

(10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위

단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황

[제출일 현재]

(성명, 학력 및 경력, 최대주주등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 등)

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고
김두경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	-	-
박영준	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	해당사항 없음	-	-
윤세리	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인율촌 대표 변호사(現)	해당사항 없음	-	-

김대일	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-	-
이창양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	해당사항 없음	-	-
최종원	행시 26회 KDI 연구위원 서울대 행정학과 교수 공정거래위원회 정책평가위원 서울대 행정대학원장 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 이사회사무국 (담당자 : 김선민 책임 ☎ 02-3459-3617)

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함	
개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 이내에 개최함
	임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함
소집권자	이사회 의장	
소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.	
결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름	
부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항	
위 임	다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항 - 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.	
의 사 록	이사회 의사에 관하여 의사록을 작성함 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)	

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석					
				김두경 (출석률: 100%)	박영준 (출석률: 100%)	윤세리 (출석률: 60%)	김대일 (출석률: 100%)	이창양 (출석률: 100%)	최종원 (출석률: 100%)
1	14.01.27	1. 실리콘화일과 '주식의 포괄적 교환' 추진(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		2. 제66기(2013년) 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		3. 제66기(2013년) 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
2	14.03.05	1. 제66기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	해당 없음
3	14.03.17	1. 실리콘화일과 주식의 포괄적 교환 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		2. SK이노베이션과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		3. SK텔레콤과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		4. SK건설과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		5. SK C&C와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		6. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음
4	14.04.01	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	14.04.23	1. 의결 안건 없음	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황 [제출일 현재]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 4명	김두경(위원장) 김대일 이창양 최종원	"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조	-
사외이사후보 추천위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	박영준(위원장) 윤세리 박성욱	"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 감사위원회

"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조

(나) 사외이사후보추천위원회

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 총 9인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 6명입니다. 사외이사는 심층면접 및 사외이사후보추천위원회의 추천에 따라 주주총회에서 선임합니다.

(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 경영참고사항 비치·공시 시(2014. 03. 05) 이사 후보에 대한 인적사항 공시

성 명 (생년월일)	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	비 고
임 형 규 (1953.02.04)	삼성종합기술원장 사장 삼성 전략기획실 신사업팀장 사장 SK 수팩스추구협의회 ICT 기술·성장 총괄 부회 장	이사회	없음	2014년 3월 21일 선임
박 성 욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 미국생산법인 담당 이사/상무 하이닉스반도체 연구소장 전무 SK하이닉스 부사장 SK하이닉스 대표이사 사장(現)	이사회	없음	
김 준 호 (1957.08.28)	법무부 부장검사 SK(주) 윤리경영실장/부사장 SK에너지(주) CMS 사장 겸) SK(주) 윤리경영부 문장 SK텔레콤(주) GMS 사장 SK하이닉스 Corporate Center장(現)	이사회	없음	-
김 두 경 (1949.10.10)	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위원
박 영 준 (1952.11.17)	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	

윤 세 리 (1953.11.20)	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인율촌 대표 변호사(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	
김 대 일 (1962.08.18)	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위원
이 창 양 (1962.09.20)	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위원
최 종 원 (1958.10.28)	행시 26회 KDI 연구위원 서울대 행정학과 교수 공정거래위원회 정책평가위원 서울대 행정대학원장 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	2014년 3월 21일 선임/ 감사위원회 위원

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적]

관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.

[권한]

- ① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[제67기(2014), 2014년 3월 21일 정기주주총회 선임 이후]

성 명	사외이사 여부	비 고
박영준	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
윤세리	○	
박성욱	X	

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			박영준(출 석률: 100%)	윤세리 (출석률: 0%)
			찬 반 여 부	
14.03.05	1. 위원장 선임의 건	가결	찬성	불참
	2. 제66기 정기주주총회에 대한 사외이사 후보 추천(안)	가결	찬성	불참

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

지원조직	구성	주요담당업무
이사회사무국	직원 3명 (팀장 1명 포함)	- 이사회 및 소위원회 지원 - 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실적

교육일시	교육내용	교육주체
2014.04.17, 15:00	- SK 사외이사 Workshop ·SK History 및 SKMS/SUPEX의 이해 ·SK 경영현황 및 따로 또 같이 3.0 체제	SK SUPEX 추구협의회

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는사외이사 4인(김두경, 김대일, 이창양, 최종원)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등
- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)
위원장은 호선에 의하여 선임
- 회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[제67기(2014), 2014년 3월 21일 정기주주총회 선임 이후]

성명	주요경력	결격요건 여부	비고
김 두 경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	위원장
김 대 일	서울대 경제학 학사 시카고대 경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-
이 창 양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	해당사항 없음	-
최 종 원	행시 26회 KDI 연구위원 서울대 행정학과 교수 공정거래위원회 정책평가위원 서울대 행정대학원장 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음	-

다. 감사위원회의 위원의 독립성

당사는 감사위원회 4인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 4인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조

③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제12조(부의사항)

3. 감사에 관한 사항

- (1) 업무·재산 조사
- (2) 자회사의 조사
- (3) 이사의 보고 수령

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.

② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)

① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치·운영 하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.

② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회차	일자	의안	가결여부	사외이사의 성명			
				김두경 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :86%)	이창양 (출석률 :100%)	최종원 (출석률 : %)
				찬반여부			
1	14.01.24	1. 내부회계관리제도 운영실태	보고	-	-	-	해당 없음
		2. '13년 하반기 업무감사실적 및 '14년 업무계획	보고	-	-	-	해당 없음
2	14.02.24	1. 2013 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-	해당 없음
		2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		3. 외부감사인 선임 승인	가결	찬성	찬성	찬성	해당 없음
3	14.03.13	1. 외부감사인 계약 보고	보고	-	-	-	해당 없음
		2. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		3. 제66기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당 없음
		4. 감사보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	해당 없음

		5. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	해당 없음
--	--	----------------------	----	----	----	----	----------

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단의 개요

- 명 칭 : SK계열

(2) 관련법령상의 규제내용 등

1) "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○
지정시기 : 1987년

○ 규제내용 요약

- 기업결합의 제한
- 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
- 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
- 기업집단 현황 공시 등

2) "은행법" 상 동일인 및 동일차주 신용공여한도 관리 대상 기업집단

○ 규제내용 요약

- 동일인 신용공여한도 : 금융기관 자기자본의 20%
- 동일차주 신용공여한도 : 금융기관 자기자본의 25%

3) "은행감독규정" 상 주채권은행 선정 대상 기업집단

○ 규제내용 요약

- 주채권은행 지정

(3) 관계회사간 출자현황

[2014년 3월 31일 기준]

(보통주 기준)

\ 피투자회사 투자회사	SK(주)	SK이노베이션	SK에너지	SK종합화학	SK텔레콤	SK네트웍스	SKC	SK건설	SK해운	SK증권
SK(주)		33.4%			25.2%	39.1%	42.5%	44.5%	83.1%	
SK이노베이션			100.0%	100.0%						
SK에너지										

SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤										
SK케미칼						0.02%		28.2%		
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C	31.8%									10.0%
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신텍										
계열사 계	31.8%	33.4%	100.0%	100.0%	25.2%	39.2%	42.5%	72.7%	83.1%	10.0%

\ 피투자회사 투자회사	SK E&S	SK가스	대한송유관 공사	충청에너지 서비스	영남에너지 서비스	코원에너지 서비스	엔티스	SK텔레콤	부산도시가스	전남도시가스
SK(주)	94.1%									
SK이노베이션			41.0%							
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤								83.5%		
SK케미칼		45.5%					50.0%			
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C	5.9%									
SK E&S				100.0%	100.0%	99.9%			67.3%	100.0%
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신텍		10.0%								
계열사 계	100.0%	55.5%	41.0%	100.0%	100.0%	99.9%	50.0%	83.5%	67.3%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	강원도시가스	전북에너지 서비스	엠앤서비스	SK와이번스	인포섹	행복나래	SK텔레시스	김천에너지 서비스	에프앤유 신용정보	하남에너지 서비스
SK(주)										
SK이노베이션						42.5%				
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤				100.0%		42.5%			50.0%	
SK케미칼										
SKC							50.0%			
SK건설										
SK가스						5.0%				
SK C&C					100.0%	5.0%				
SK E&S	100.0%	100.0%						80.0%		
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛			100.0%							
SK하이닉스										
코원에너지서비스										100.0%
SK신텍										
계열사 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.0%	50.0%	80.0%	50.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	SK디앤디	내트릭	SK하이닉스	스피드모터스	SK모바일 에너지	SK유화	SK커뮤니 케이션즈	SK플래닛	SKC에어가스	SK네트웍스 서비스
SK(주)										
SK이노베이션					100.0%					
SK에너지		100.0%								
SK종합화학						100.0%				
SK네트웍스				100.0%						86.5%
SK텔레콤			20.6%					100.0%		
SK케미칼										
SKC									80.0%	
SK건설	45.0%									
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛							64.5%			
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신텍										
계열사 계	45.0%	100.0%	20.6%	100.0%	100.0%	100.0%	64.5%	100.0%	80.0%	86.5%

\ 피투자회사 투자회사	커머스플래닛	이니츠	SKC솔믹스	SK브로드밴드	엘씨앤씨	피엠티	PS&마케팅	유비케어	평택에너지 서비스	위례에너지 서비스
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스					100.0%					
SK텔레콤				50.6%			100.0%			
SK케미칼		66.0%						44.0%		
SKC			41.4%							
SK건설										
SK가스										
SK C&C										
SK E&S						100.0%			100.0%	89.5%
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛	100.0%									
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신텍										
계열사 계	100.0%	66.0%	41.4%	50.6%	100.0%	100.0%	100.0%	44.0%	100.0%	89.5%

\ 피투자회사 투자회사	제주유나이티 드 FC	MKS캐런티	SK임업	SK루브리컨츠	SKC라이팅	비젠	SK하이이엔지	SK하이스텍	실리콘화일	SK바이오팜
SK(주)			100.0%							100.0%
SK이노베이션				100.0%						
SK에너지	100.0%									
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤										
SK케미칼										
SKC					98.8%					
SK건설										
SK가스										
SK C&C						99.0%				
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D		100.0%								
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스							100.0%	100.0%	27.9%	
코원에너지서비스										
SK신텍										
계열사 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.8%	99.0%	100.0%	100.0%	27.9%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	SK신택	대전얌은물	광주얌은물	에스케이 더블유	텔레비전 미디어코리아	네트웍 오앤에스	서비스에이스	서비스탑	SK핀크스	유베이스매뉴 팩처링아시아
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스									100.0%	
SK텔레콤						100.0%	100.0%	100.0%		
SK케미칼	100.0%									
SKC				90.0%						
SK건설		32.0%	42.0%							
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										100.0%
SK해운										
SK플래닛					51.0%					
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신택										
계열사 계	100.0%	32.0%	42.0%	90.0%	51.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	울산아로마텍스	SK컨티넨탈 이모션코리아	지허브	SK인천 석유화학	SK트레이딩 인터내셔널	보령 LNG터미널
SK(주)						
SK이노베이션				100.0%	100.0%	
SK에너지						
SK종합화학	50.0%					
SK네트웍스						
SK텔레콤						
SK케미칼						
SKC						
SK건설						
SK가스			100.0%			
SK C&C						
SK E&S						50.0%
SK커뮤니케이션즈						
SK브로드밴드						
SK D&D						
SK-컨티넨탈이모션		100.0%				
SK루브리컨츠						
SK해운						
SK플래닛						
SK하이닉스						
코원에너지서비스						
SK신택						
계열사 계	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%

(*) 사명 변경 : 울산아로마텍스(주) (舊 아로케미(주)), 행복나래(주) (舊 엠알오코리아(주)), 비젠(주) (舊 텔스크(주)), SK하이신택(주) (舊 (주)하이신택), 에스케이하이이엔지(주) (舊 (주)하이닉스엔지니어링) 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주))

(4) 계열회사 관리조직 현황

[SK하이이엔지, SK하이신택]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영기획팀에서 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영기획팀은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 서비스도급계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[실리콘화일]

당사는 CIS(CMOS 이미지 센서)사업에 진출하면서 보다 빠른 시일 내에 사업경쟁력을 확보하기 위해, 설계 경쟁력을 갖추고 있는 국내 팹리스 업체인 실리콘화일과 2007년 11월에 CIS 기술공동개발, 판권허여 및 파운드리 협력계약을 체결하였고, 2008년 8월에는 협력관계를 보다 강화하기 위해 주식인수를 통하여 실리콘화일의 경영권을 확보한 바 있습니다. 또한, 2009년 9월에는 공간적 통합을 통한 개발 효율성 및 성과 극대화 도모를 위해 CIS 사업 협력 강화를 위한 합의를 체결하였습니다.

본 보고서 제출일 현재 당사는 최대주주로서 실리콘화일과 특별약정을 체결하고, 1인의 이사를 선임하여 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련하여 당사와 사전에 협의토록 하고 있으며, 계약 관계 및 기타 이사회 관련 사항 등 경영 사안에 대해 조정하고 있습니다.

[SKHYA, SKHYD, SKHYU, SKHYJ, SKHYS, SKHYIS, SKHYH, SKHYT, SKHYCS, SKHYCW]
 당사의 상기 계열회사들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매행위를 대행하며, 이에 계열회사 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 계열회사는 본사 조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다. 계열회사의 영업활동에 필요한 제반항목에 대해 본사의 마케팅전략팀이 커뮤니케이션 창구로서의 지원 업무를 수행하며 영업과 무관한 고유업무는 해당기능의 본부에서 관할합니다.

(5) 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[제출일 현재]

겸직임원		겸직 계열회사		비고
성명	직위	회사명	상근여부	
박성욱	대표이사/사장	SK hynix America Inc.	비상근	-
		SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-
김준호	Corporate Center장	SK hynix America Inc.	비상근	-
		SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-
김두경	사외이사	(주)JB금융지주	사외이사	-
윤세리	사외이사	두산인프라코어(주)	사외이사	-
최종원	사외이사	두산건설(주)	사외이사	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초 취득일자	출자 목적	최초 취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
에스케이하이이앤지(주)	2001.07.05	경영참가	15,032	674,327	100.00	15,154			0	674,327	100.00	15,154	56,725	6,693
에스케이하이이스텍(주)	2008.03.15	경영참가	5,840	277,203	100.00	6,760			0	277,203	100.00	6,760	29,906	3,193
(주)실리콘화일	2008.08.12	경영참가	22,835	2,358,832	27.93	8,138			0	2,358,832	27.93	8,138	65,689	9,326
SK hynix America Inc. (SKHYA)	1983.03.15	경영참가	1,231,196	6,285,587	97.74	31			0	6,285,587	97.74	31	964,682	23,547
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc.(HsMA)	2004.07.09	경영참가	98	100,000	0.05	0			0	100,000	0.05	0	50,710	-6,427
SK hynix Deutschland GmbH.(SKHYD)	1989.03.01	경영참가	80,956	출자증서	100.00	22,011			0	출자증서	100.00	22,011	98,150	2,440

SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE)	1995.04.27	경영참가	446,766	335,640,000	100.00				0	335,640,000	100.00	0	0	0
SK hynix UK Ltd.(SKHYU)	2013.11.05	경영참가	1,775	186,240,200	100.00	1,775			0	186,240,200	100.00	1,775	78,020	1,743
SK hynix Asia Pte. Ltd. (SKHYS)	1991.09.12	경영참가	137,531	196,303,500	100.00	52,380			0	196,303,500	100.00	52,380	231,649	2,385
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd. (SKHYH)	1995.04.27	경영참가	223,233	170,693,661	100.00	32,623			0	170,693,661	100.00	32,623	353,248	19,471
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	2006.06.29	경영참가	6,357	출자증서	100.00	4,032			0	출자증서	100.00	4,032	33,845	4,263
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1996.09.16	경영참가	81,587	20,000	100.00	42,905			0	20,000	100.00	42,905	302,971	10,335
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. (SKHYT)	1996.09.16	경영참가	13,330	35,725,000	100.00	37,562			0	35,725,000	100.00	37,562	240,489	6,680
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)	2007.03.29	투자	5	270	1.00	5			0	270	1.00	5	1,647	175
SK hynix Semiconductor (China) Ltd. (SKHYCL)	2005.06.30	경영참가	1,866,810	출자증서	90.26	2,421,631			0	출자증서	90.26	2,421,631	3,652,044	23,611
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	2006.04.17	경영참가	47,384	출자증서	100.00	238,271			0	출자증서	100.00	238,271	249,498	-192
Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	2009.11.17	경영참가	90,150	출자증서	45.00	92,608			0	출자증서	45.00	92,608	591,707	40,418
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	2010.07.29	경영참가	237	출자증서	100.00	237			0	출자증서	100.00	237	5,362	76
SK hynix Italy(SKHYIT)	2012.05.11	경영참가	18	출자증서	100.00	18			0	출자증서	100.00	18	4,781	431
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	2012.08.20	경영참가	282,293	105	100.00	287,603			0	105	100.00	287,603	14,548	-3,382
SK hynix Semiconductor Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	2012.08.29	경영참가	7,819	출자증서	100.00	7,819			0	출자증서	100.00	7,819	8,246	34
SK APTech Ltd.	2013.09.02	경영참가	38,836	50,000,000	100.00	54,681	30,000,000	32,292	0	80,000,000	100.00	86,973	53,079	4
현대정보기술㈜	1994.03.24	투자	3,481	1,160,180	2.30	1,885			-255	1,160,180	2.30	1,630	150,247	-18,370
현대이비티㈜	2007.03.23	출자전환	63	25,286	0.01	4			0	25,286	0.01	4	30,843	-10,352
(주)피블릭스	2008.04.18	투자	3,560	1,605,854	8.79	3,870			161	1,605,854	8.79	4,031	58,858	4,737
(주)아이에이	2008.09.03	투자	4,508	1,031,590	3.90	3,389			3,162	1,031,590	3.90	6,551	67	-6
(주)에이티세미콘	2006.03.13	투자	1,166	481,780	1.04	768			-19	481,780	1.04	749	239,912	-13,393
현대로지스틱스(주)	1995.10.16	투자	76	15,115	0.08	98			0	15,115	0.08	98	806,383	-76,596
(주)이큐베스텍	2002.01.18	투자	10	2,000	1.67	10			0	2,000	1.67	10	4,378	115
Sky Property	2013.12.27	투자	112,361	5,745	15.00	112,361			0	5,745	15.00	112,360	829,185	11,614
Phison Electronics Corp.	2008.07.16	투자	11,661	3,277,054	1.82	22,050			456	3,277,054	1.82	22,506	702,190	111,923
특정금전신탁	2008.11.17	투자	21,847	201,600,000	7.93	0			0	201,600,000	7.93	0	1,405,327	-470,296
인텔렉추얼디스커버리	2011.05.13	투자	4,000	800,000	8.94	4,000			0	800,000	8.94	4,000	48,125	-12,619
기타	-	투자	16,332			2			0			2		
합 계						3,474,681			3,505			3,510,477		

※ 최근 사업년도 재무현황은 2013년말 실적이며, 미공시 법인은 2013년 9월말 재무제표를 반영

※ 법인명 '기타' 항목은 손상차손 및 출자전환 주식으로 장부가액이 감소한 법인들을 표시함

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에스케이텔레콤(주)	최대 주주	보통주	146,100,000	21.05	146,100,000	20.57	유상증자 참여 /구주지분 인수
최신원	특별 관계자	보통주	9,000	0.00	9,000	0.00	장내매수
박성욱	특별 관계자	보통주	1,394	0.00	1,394	0.00	장내매수
김준호	특별 관계자	보통주	8,940	0.00	8,940	0.00	장내매수
엄낙용	특별 관계자	보통주	40	0.00	0	0.00	임원퇴임
임형규	특별 관계자	보통주	0	0.00	5,000	0.00	장내매수
계		보통주	146,119,374	20.57	146,124,334	20.57	-
		합 계	146,119,374	20.57	146,124,334	20.57	-

최대주주명 : 에스케이텔레콤(주)

특수관계인의 수 : 4 명

(주1) 최대주주(법인)에 대한 개요

에스케이텔레콤은 정보통신업, 단말기 매매 및 임대업, 뉴미디어사업 등을 영위하는 사업자로 1984년 3월 29일 설립되었습니다. 에스케이텔레콤은 단말, 요금제, 네트워크, 콘텐츠등의 본원적 경쟁력을 기반으로 하여 이동통신서비스를 제공하고 있으며, 국내 최초 LTE 상용화를 통해 기존에는 유선 네트워크 환경에서 가능했던 고품질의 동영상 서비스 및 멀티미디어 게임 등 다양한 서비스가 무선 환경에서도 활성화될 수 있는 제공 기반을 마련하였습니다. 2014년 3월 21일 정기주주총회 기준 에스케이텔레콤의 등기임원은 총 8명으로 사내이사 3명(하성민, 조대식, 지동섭), 사외이사 5명(오대식, 임현진, 정재영, 이재훈, 안재현)으로 구성되어 있습니다.

- 등기임원 현황

이름	약력
하성민	- SK텔레콤 경영기획실장(前) - SK텔레콤 경영지원부문장(前) - SK텔레콤 MNO Biz 사장(前) - SK텔레콤 대표이사/사장(現)

조대식	- SK(주) 재무담당(前) - SK(주) 경영분석실장(前) - SK(주) 사업지원부문장(前) - SK(주) 재무팀장 겸 자율책임경영지원단장(前) - SK(주) 사장(現)
지동섭	- SK(주) 기업문화부문장(前) - SK텔레콤 IPE 사업단장(前) - SK텔레콤 MNO기획실장(前) - SK텔레콤 미래경영실장(現)
오대식	- 국세청 정책홍보관리관(前) - 국세청 조사국 국장(前) - 서울지방국세청 청장(前) - 법무법인 태평양 고문(現)
임현진	- 미국 듀크대 사회학과 초빙교수(前) - 제48대 한국사회학회 회장(前) - 서울대학교 사회과학대학 학장(前) - 서울대학교 사회과학대학 사회학과 교수(現) - 서울대학교 아시아연구소 소장(現)
정재영	- 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 부총장(前) - 포스코 사외이사(前) - 성균관대학교 경영학부 교수(前) - 성균관대학교 명예교수(現)
이재훈	- 지식경제부 제2차관(前) - 산업자원부 제2차관(前) - 산업자원부 차관보(前) - 에너지자원개발미래전략포럼 대표(現)
안재현	- KAIST정보미디어 경영대학원장(前) - 한국 미디어 경영학회 회장(前) - 미국 AT&T 벨연구소 선임연구원(前) - KAIST 경영대학 교수, 대외부학장(現)

- 재무현황

(단위: 백만원)

구분	2013년말	2012년말
자산총계	26,576,515	25,595,560
부채총계	12,409,958	12,740,777
자본총계	14,166,557	12,854,782
영업이익	2,011,109	1,730,049
당기순이익	1,609,549	1,115,663

나. 최대주주의 변동 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비고
-	(주)한국외환은행	37,742,000	8.2	-
-	(주)한국외환은행	37,742,000	8.2	-
2009년 01월 17일	(주)한국외환은행	37,742,000	7.3	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2009년 05월 19일	(주)한국외환은행	37,742,000	6.4	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2010년 03월 16일	한국정책금융공사	32,412,935	5.5	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 03월 19일	미래에셋자산운용투자자문(주)	35,362,056	6.0	장내 매수/매도
2010년 05월 04일	미래에셋자산운용투자자문(주)	44,041,030	7.46	장내 매수/매도
2010년 08월 03일	한국정책금융공사	32,412,935	5.50	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 10월 11일	국민연금공단	35,894,454	6.08	장내 매수/매도
2011년 01월 10일	국민연금공단	47,786,668	8.10	장내 매수/매도
2011년 04월 11일	국민연금공단	53,774,325	9.11	장내 매수/매도
2011년 07월 08일	국민연금공단	47,838,426	8.08	장내 매수/매도
2011년 10월 07일	국민연금공단	54,202,391	9.15	장내 매수/매도
2012년 02월 15일	에스케이텔레콤(주)	146,100,000	21.05	유상증자 참여 및 구주 지분인수
2012년 02월 23일	에스케이텔레콤(주)	146,105,000	21.05	특별관계자 추가
2012년 04월 02일	에스케이텔레콤(주)	146,119,894	21.05	계열편입에 따른 특별관계자 추가
2012년 06월 22일	에스케이텔레콤(주)	146,127,934	21.05	특별관계자 추가
2013년 05월 09일	에스케이텔레콤(주)	146,115,374	20.57	특별관계자 제외 및 추가
2014년 01월 06일	에스케이텔레콤(주)	146,119,374	20.57	장내 매수
2014년 03월 27일	에스케이텔레콤(주)	146,124,334	20.57	특별관계자 제외 및 추가

2. 주식의 분포

가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	에스케이텔레콤(주)	146,124,334	20.57	(주1)

	국민연금공단	66,460,851	9.36	(주2)
	우리사주조합	-	-	-

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특별관계자의 보유주식 24,334주를 합산한 것임.

(주2) 상기 국민연금공단의 보유내역은 2013년 12월 31일자 주주명부 기준임.

나. 주주 분포

[실질주주기준]

(기준일: 2013년 12월 31일)

구분	주주수	비율	주식수	비율	비고
소액주주 합계	224,206	99.99	486,844,385	68.55	-
소액주주(법인)	1,897	0.84	113,883,713	16.03	-
소액주주(개인)	222,309	99.15	372,960,672	52.51	-
대주주 1인	1	0.00	101,850,000	14.34	-
기타주주 합계	6	0.00	121,506,506	17.10	-
기타주주(법인)	4	0.00	95,852,636	13.49	-
기타주주(개인)	2	0.00	25,653,870	3.61	-
합계	224,213	0.00	710,200,891	100.00	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2013년 12월 31일 기준임.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	<p>제10조(신주인수권)</p> <p>① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 신주를 인수하게 하는 경우 <개정 2009.3.26> 2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하게 하는 경우 <개정 2009.3.26> 3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 <개정 2009.3.26> 4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 <개정 2009.3.26> 5) 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 <개정 2000.3.24, 2009.3.26> 6) 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융 기관 (여기서 '금융기관'이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전
------------------	---

	략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 <개정 1999.3.26, 2001.3.29, 2009.3.26, 2010.3.26> 7) 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 8) 회사가 "경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자"에게 신주를 발행하는 경우 [신설 1999.3.26] <개정 2009.3.26> 9) 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우[신설 1999.3.26] 10) 근로자복지기본법의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 [신설 2006.3.28] ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.		
결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중
주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권 (8종)		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지게재<개정 2012.03.23>

4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종류		'14년 03월	'14년 02월	'14년 01월	'13년 12월	'13년 11월	'13년 10월
보통주	최고주가	39,450	39,900	39,000	37,150	35,450	34,600
	최저주가	36,000	36,500	35,250	34,250	31,500	29,950
	평균주가	37,831	38,778	37,008	36,013	33,019	32,821
거래량	최고일거래량	8,111	6,520	11,312	6,726	6,945	20,162
	최저일거래량	1,659	1,740	2,174	2,089	1,826	2,875
	월간거래량	66,767	70,030	96,379	80,388	74,179	129,309

※ 주가는 일별 증가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 룩셈부르그]

(단위 : USD, DR)

종류		'14년 03월	'14년 02월	'14년 01월	'13년 12월	'13년 11월	'13년 10월
GDR	최 고	-	-	-	-	-	-
	최 저	-	-	-	-	-	-
월간거래량		-	-	-	-	-	-

※ GDR의 거래량은 미미하며, 장외비중이 크므로 거래량의 정확한 산정이 어려워 기재를 생략함.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(1) 등기임원의 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								보통주	우선주		
임형규	남	1953년 02월	부회장	등기임원	상근	부회장	플로리다대 반도체 공학 박사 삼성종합기술원장 사장 삼성 전략기획실 신사업팀장 사장 SK 수퍼스추구협의회 ICT 기술·성장 총괄 부회장	5,000	-	선임(14.03.21)	-
박성욱	남	1958년 01월	사장	등기임원	상근	대표이사 사외이사후보 추천위원회 위원	한국과학기술원(KAIST) 재료공학 박사 SK하이닉스 연구개발총괄	1,394	-	선임(09.03.26) 중임(12.02.14)	-
김준호	남	1957년 08월	사장	등기임원	상근	Corporate Center장	고려대 법학 학사 법무부 부장검사 SK(주) 윤리경영실장/부사장 SK에너지(주) CMS 사장 겸 SK(주) 윤리경영부문장 SK텔레콤(주) GMS 사장	8,940	-	선임(13.03.22)	-
김두경	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	-	-	선임(12.02.14)	-
박영준	남	1952년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보 추천위원회 위원	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	-	-	선임(12.02.14)	-
윤세리	남	1953년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보 추천위원회 위원	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인윌촌 대표 변호사(現)	-	-	선임(12.02.14)	-

김대일	남	1962년 08월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	-	-	선임(12.02.14)	-
이창양	남	1962년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	-	-	선임(12.02.14)	-
최종원	남	1958년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 경제학 학사/행정학 석사 미시간대 정책학 박사 행정고시 26회 KDI 연구위원 서울대 행정대학원장 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원 교수(現)	-	-	선임(14.03.21)	-

(2) 등기임원의 겸직 현황

[제출일 현재]

겸직임원		겸직회사		비고
성명	직위	회사명	직위	
박성욱	대표이사/사장	SK hynix America Inc.	이사	
		SK hynix Semiconductor China Ltd.	이사	
김준호	Corporate Center장	SK hynix America Inc.	이사	
		SK hynix Semiconductor China Ltd.	이사	
김두경	사외이사	(주)JB금융지주	사외이사	
윤세리	사외이사	두산인프라코어(주)	사외이사	
최종원	사외이사	두산건설(주)	사외이사	

(3) 미등기 임원 현황(제출일 현재)

직명 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약력	담당업무	소유주식수		비고
							보통주	우선주	
회장 (비상근)	미등기임원	최태원	남	60.12.03	미국 시카고대 경제학 박사수료 SK하이닉스 대표이사	회장	-	-	-
사장 (상근)	미등기임원	오세용	남	54.12.15	MIT(재료) 박사 AIPT	제조/기술부문장	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	김용탁	남	58.09.25	성균관대(전자) 학사 DRAM개발본부장	개발부문장	17,548	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	김동균	남	57.11.05	고려대(재료) 학사 FAB제조본부장	환경안전본부장	5,428	-	-

전무 (상근)	미등기임원	김진웅	남	64.02.01	KAIST(재료) 박사 FLASH공정그룹장	Flash Tech개발본부장	2,771	-	-
전무 (상근)	미등기임원	송현중	남	65.11.23	M.I.T(경영) 석사 SK텔레콤	미래전략본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	양예석	남	60.01.11	인하대(화학) 학사 Mobile개발본부장	품질보증본부장	428	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이명영	남	62.02.20	연세대(경영) 학사 SK네트웍스	재무본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이상선	남	61.09.23	고려대(전기) 학사 M11제조기술/신제품그룹장	청주FAB장	4,000	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이석희	남	65.06.23	Stanford Univ.(재료) 박사 KAIST 교수	미래기술연구원장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	진교원	남	62.09.22	서울대(물리) 학사 상품기획그룹장	Flash상품기획실장	112	-	-
전무 (상근)	미등기임원	진정훈	남	63.10.21	JOHN MARSHALL LAW SC 박사 해외영업단장	마케팅본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	최영규	남	57.01.18	North carollina State Univ.(전산학) 석사 SKHMS	Flash Solution 개발본부 SoftwareEngineering TF장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	최영준	남	63.01.09	동국대(전자) 학사 Flash상품기획그룹장	Flash Solution 개발본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	한성규	남	58.10.27	경북대(전자) 학사 제조본부장	SystemIC사업부장	2,932	-	-
전무 (상근)	미등기임원	현순엽	남	63.10.27	서울대(경영) 석사 SK이노베이션	기업문화본부장	3,520	-	-
전무 (상근)	미등기임원	홍성주	남	62.11.06	KAIST(물리학) 박사 연구소장	DRAM개발본부장	6,842	-	-
상무 (상근)	미등기임원	곽노정	남	65.11.06	고려대(재료) 박사 DRAM공정D팀장	GLDP 파견	1,103	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김남석	남	67.02.20	서울대(금속) 박사 PKG연구1그룹장	PKG&TEST P기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김상근	남	62.01.05	동아대(전기) 학사 설비기술혁신그룹장	환경안전본부 설비기술실 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영호	남	61.05.17	고려대(재료) 학사 M10Yellow제조기술그룹장	SCM실 구매1실장	328	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김용근	남	62.10.22	동아대(전자) 학사 제조전략그룹장	생산기술본부 EE그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김윤생	남	63.08.06	홍익대(전자) 석사 핵심설계기술그룹장	DRAM개발본부 설계기술 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김은대	남	58.11.12	인하대(전자) 학사 특허그룹장	윤리경영실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김중호	남	67.01.12	고려대(전자)학사 Flash&CIS마케팅그룹장	마케팅본부 Flash마케팅그 룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김진국	남	64.07.17	연세대(전기) 학사 Mobile소자그룹장	Mobile개발본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김태훈	남	63.02.17	경북대(전기)학사 CF Yellow제조기술그룹장	청주FAB FC기술그룹장	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	김현곤	남	62.07.17	KAIST(물리) 박사 Mobile개발그룹장	Mobile개발본부 Mobile설 계그룹장	429	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김현수	남	65.07.19	KAIST(물리) 박사 기술기획팀장	미래기술연구원 수율개선 그룹장	112	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김형수	남	65.02.24	KAIST(재료) 박사 기술기획팀장	미래기술연구원 NM공정그 룹장	500	-	-
상무 (상근)	미등기임원	민경현	남	66.01.19	New York Univ.(법학) 석사 특허그룹장	대외협력본부 법무특허실 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박근우	남	66.04.20	KAIST(전자) 석사 선행설계그룹장	Flash Tech개발본부 Flash설계그룹장	1	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박래학	남	61.05.05	한양대(물리) 학사 MobileSolution마케팅그룹장	마케팅본부 DRAM&ICS마 케팅그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박성기	남	59.08.12	연세대(요업) 학사 연구소 NM공정그룹장	미래기술연구원 공정그룹 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박영기	남	59.03.07	동아대(전자) 학사 TEST기반기술2팀장	PKG&TEST FT기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박윤세	남	59.04.25	연세대 고체물리 석사 S FAB	생산기술본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박재광	남	66.04.06	Havard Univ.(종교학) 석사 SK이노베이션	마케팅본부 마케팅 GlobalizationTF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박재수	남	61.04.26	경북대(전자) 학사 M10Yellow제조기술그룹	이천FAB PE-TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박정식	남	63.12.05	홍익대(전자) 석사 D-TEST기술그룹장	PKG&TEST장	112	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박주석	남	64.06.23	충북대(전기전산) 석사 MM소자그룹장	DRAM개발본부 DRAM소 자그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박철수	남	61.03.24	연세대(경영) 석사 자동화기술혁신그룹장	생산기술본부 FA그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	사택진	남	61.11.20	고려대(경영) 석사 회계팀장	재무본부 회계관리실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	손기근	남	63.10.30	한양대(재료) 학사 공정개발팀장	SystemIC사업부 M8그룹 장	292	-	-
상무 (상근)	미등기임원	송창록	남	69.01.20	서울대(무기재료) 박사 공정관리10B팀장	이천FAB DI수율그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	신승국	남	62.11.03	Vanderbilt Univ.(법학) 박사 SK에너지	대외협력본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	신희풍	남	60.10.22	인하대(회계) 학사 원가그룹장	G-ERPTF G-ERP추진실 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안근욱	남	59.08.15	단국대(전자) 학사 리디스테크놀로지	Flash Tech개발본부 Flash소자그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	양종섭	남	64.12.19	KAIST(물리) 석사 Flash제품그룹장	Flash Solution개발본부 MobileSolution그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	오종훈	남	64.08.20	서울대(전자) 학사 SKHYA	DRAM상품기획실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	위보령	남	64.06.26	KAIST(물리) 박사 MM소자1팀장	DRAM개발본부 응용기술 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	유경동	남	61.12.23	옥스포드(재료) 박사 CIS개발설계그룹장	SystemIC사업부 개발그룹 장	2,480	-	-

상무 (상근)	미등기임원	윤건상	남	62.10.05	성균관대(전자) 학사 제품기술그룹장	DRAM개발본부 제품기술 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이동재	남	62.10.02	성균관대(전자) 학사 SK건설	미래기술전략총괄 미래사 업추진단장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이병석	남	61.03.25	영남대(화학) 석사 Flash공정그룹장	미래기술연구원 Etch팀장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이상락	남	68.01.10	연세대(전기) 학사 GlobalAccount영업팀장	마케팅본부 영업2그룹장	40	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이상래	남	65.07.09	Boston(MBA) 기술경영팀장	SC사업기획본부파견	2	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이석규	남	63.12.21	서울대(재료) 박사 Flash소자기술그룹장	미래기술연구원 Flash소자 기술팀장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이성동	남	65.03.04	서강대(전자) 학사 TEST기반기술팀장	PKG&TEST C-P&T그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이우빈	남	64.10.27	Univ. of Washington(전자) 박사 Aptina	미래기술전략총괄 H-TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이정훈	남	64.06.10	연세대(물리) 석사 선행소자그룹장	미래기술연구원 선행소자 그룹장	2,500	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이종수	남	62.08.03	광운대(재료) 석사 사업화그룹장	SystemIC사업부 사업화그 룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이철호	남	60.09.15	광운대(재료) 학사 DRAM품질보증그룹장	현장경영실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이희기	남	64.07.13	인하대(전기) 학사 Flash제품그룹장	Flash Tech개발본부 Flash제품그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임동규	남	64.04.10	서울대(물리교육) 박사 선행공정1팀장	미래기술연구원 MASK기 반기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임성빈	남	63.06.17	울산대(기계) 학사 M12그룹장	청주FAB FC-FAB그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임종필	남	60.11.14	고려대(화학공업) 학사 SK텔레콤	SCM본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장종태	남	64.10.20	한양대(사회학) 학사 SK텔레콤	기업문화본부 총무/인력개 발실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장태식	남	61.10.02	고려대(전자) 학사 Mobile소자1팀장	Mobile개발본부 Mobile소 자그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장희현	남	63.01.26	연세대(전자) 학사 F소자C팀장	Flash Tech개발본부 F소 자C팀장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전준현	남	66.05.19	경북대(전자) 학사 DRAM제품설계그룹장	DRAM개발본부 DRAM제 품설계그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정의삼	남	65.03.01	고려대(화공) 학사 투자기획팀장	제조/기술부문 M&T기획그 룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정재관	남	60.09.09	영남대(물리) 석사 MM소자2팀장	미래기술연구원 소자기술 그룹장	2,144	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최근민	남	69.09.20	Tohoku Univ.(전자) 박사 우시-제조기술그룹장	이천FAB장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최봉호	남	62.09.20	연세대(요업) 석사 DRAM공정E팀장	이천FAB DI기술그룹장	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최석문	남	66.04.13	Univ. of Michigan(경영) 석사 SK텔레콤	미래전략본부 경영기획실 장	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	최석훈	남	57.12.23	일산고등학교 노사협력그룹장	청주지원본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최춘엽	남	60.08.28	전북대(경영) 학사 SKHYD 법인장	마케팅본부 영업1그룹장	1,428	-	-
상무 (상근)	미등기임원	피승호	남	66.04.10	KAIST(재료) 박사 Flash공정1팀장	미래기술연구원 Flash공정 1팀장	569	-	-
상무 (상근)	미등기임원	한종희	남	66.01.07	KAIST(반도체) 박사 StorageSolution그룹장	Flash Solution개발본부 StorageSolution그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	허용진	남	61.02.13	건국대(전자) 석사 공정관리CF/A팀장	청주FAB FC수율그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	허현국	남	65.03.03	부산대(경제학) 학사 노사지원팀장	청주지원본부 청주경영지 원실장	71	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍상후	남	63.02.20	성균관대(전자) 학사 품질기술담당	품질보증본부 Solution품 질보증그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍재근	남	63.01.26	광운대(전자) 학사 Mobile응용그룹장	Mobile개발본부 Mobile응 용그룹장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	곽봉수	남	64.01.29	서울대(경영) 석사 HR그룹장	CorporateCenter CC지원 담당	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	김기석	남	62.06.26	연세대(물리) 박사 F소재팀장	미래기술연구원 Flash소재 기술팀	1,612	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	김대영	남	62.09.21	부산대(재료) 학사 DDRAM소재1팀장	DRAM개발본부 DRAM소 자TD팀장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	김영래	남	66.01.25	연세대(전자) 학사 FlashServer마케팅팀장	마케팅본부 FlashComputing마케팅팀 장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	김영서	남	63.11.30	광운대(재료) 학사 생산추진1그룹장	환경안전본부 환경안전실 장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	김영일	남	65.10.13	Univ. of Denver(경영) 석사 기술전략팀장	개발부문 기술전략그룹장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	김윙희	남	61.03.15	고려대(물리) 학사 DRAM제품2팀장	DRAM개발본부 DRAM제 품기술PD팀장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	김주선	남	66.06.01	성균관대(산업공학) 학사 영업기획팀장	마케팅본부 마케팅전략그 룹장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	박철규	남	66.06.16	경북대(전자) 학사 DRAM품질기술팀장	품질보증본부 DRAM품질 보증그룹장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	박현열	남	59.08.10	서울시립대(화공) 학사 품질혁신그룹장	제조/기술부문 QE그룹장	1,728	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	백현철	남	65.03.15	고려대(화학) 학사 수율개선1팀장	미래기술연구원 DRAM공 정2팀장	630	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	안규옥	남	62.09.01	중앙대(회계) 석사 원가그룹장	재무본부 수익성분석실장	9	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	안현	남	67.06.04	서울대(원자핵공학) 박사 경영전략팀장	미래전략본부 경영전략실 장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	유상동	남	65.12.10	한양대(전자) 박사 Analog/PX설계팀장	SystemIC사업부 설계그룹 장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	전영호	남	61.04.01	광운대(전자) 학사 공정개선CF/A팀장	청주FAB T-Project장	642	-	-

상무보 (상근)	미등기임원	전윤석	남	64.12.25	Univ.of Utah(재료) 박사 기술기획팀장	미래기술연구원 R- Project장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	조진욱	남	65.07.02	Southern Illinois Univ.(전자) 석사 미래상품기획팀장	DRAM상품기획실 미래상 품기획팀장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	차선용	남	67.08.04	KAIST(전기전자공학) 박사 소자기술D팀장	미래기술연구원 DRAM소 자기술D팀장	400	-	-
최고 연구위원 (상근)	미등기임원	서광벽	남	54.08.12	North Carolina(재료) 박사 코아로직	미래기술전략총괄	-	-	-
수석연구위 원 (상근)	미등기임원	노재성	남	60.11.27	KAIST(재료) 박사 NM공정S팀	미래기술연구원 NM공정 S팀장	2,586	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	권원택	남	62.10.10	광운대(전자) 학사 미래기술연구원 Flash공정P팀	미래기술연구원 Photo팀 장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김영수	남	64.02.20	Polytechnic Univ.(고분자) 박사 미래기술연구원 DRAM공정P팀장	미래기술연구원 Photo팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김태훈	남	70.02.22	Arizona State Univ.(전자) 박사	미래기술연구원 선행소자 Ntt팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	박성계	남	67.06.21	KAIST(전자) 박사 소자기술D팀장	미래기술연구원 Flash소자 기술D팀장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	박성수	남	65.02.09	KAIST(전기전자공학) 박사 Silicon Image	Flash Solution개발본부 차 세대개발TF장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	복철규	남	64.07.25	연세대(경영) 석사 DRAM공정P팀	미래기술연구원 Photo팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	아리토메 세이이치	남	60.08.09	Hiroshima Univ.(전기) 석사	미래기술연구원 소자기술 그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	양현조	남	63.11.28	연세대(요업) 석사 노광OPC팀	미래기술연구원 노광 OPC팀장	508	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이재진	남	63.10.30	서울대(물리) 학사 Graphics설계팀장	DRAM개발본부 HBM설계 팀장	5,609	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이창세	남	63.02.07	San Jose State Univ.(경영) 석사	Flash Solution개발본부 SoCArchitecture팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	임찬	남	66.01.12	연세대(물리) 석사 F소자D팀	미래기술연구원 Flash소자 기술D팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	임창문	남	66.06.15	KAIST(물리) 박사 DRAM공정P팀	미래기술연구원 Photo팀	8,500	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	전홍신	남	67.08.22	서강대(전자) 박사 핵심제품팀	DRAM개발본부 TSV제품 기술팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	조규석	남	64.01.18	KAIST(반도체) 박사 F소자D팀	미래기술연구원 Flash소자 기술D팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	조명관	남	66.05.17	포항공대(전자) 박사 F소자3팀장	Flash Tech개발본부 F소 자D팀장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	조한욱	남	69.05.30	한양대(컴퓨터통신) 박사	FlashSolution개발본부 UFS-FW개발팀장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	최기식	남	68.08.13	Texas Tech Univ.(전자) 박사 DRAM소자기술팀	미래기술연구원 DRAM소 자기술D팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	최재훈	남	61.08.27	KAIST(물리) 박사 DMR팀	미래기술연구원 DMR팀장	9,040	-	-

연구위원 (상근)	미등기임원	홍권	남	65.11.03	고려대(요업) 박사 NM공정P팀장	미래기술연구원 기술기획 팀장	-	-	-
기술위원 (상근)	미등기임원	나한주	남	63.05.22	서강대(물리) 학사 SSD기술팀장	PKG&TEST SSD기술팀장	-	-	-
기술위원 (상근)	미등기임원	이한주	남	65.11.15	성균관대(기계) 학사 A-Project	생산기술본부 S-Project장	-	-	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 천원)

사업부문	성별	직원 수				평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
		정규직	계약직	기 타	합 계				
-	남	11,292	1	-	11,293	10.1	367,665,055	32,557	-
-	여	9,105	8	-	9,113	8.2	194,342,896	21,326	-
합 계		20,397	9	-	20,406	9.2	562,007,951	27,541	-

※ 상기 직원의 수는 본사기준이며, 사내이사 제외 기준임.

※ 상기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.

※ 상기 급여총액에는 성과급이 포함되어 있음.

다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고
가입대상	이천 7,372명 / 청주 5,139명	-
가입인원	이천 7,174명 / 청주 5,088명	-
근로시간 면제자	이천 10명 / 청주 6명	-
소속된 연합단체	한국노총 금속연맹	-
기 타	-	-

라. 회계 및 공시 전문인력 보유현황

구 분	보 유 인 원	담 당 업 무	비 고
미국공인회계사	3	재무회계	-
	2	관리회계	-
	1	재무관리	-
공인회계사	1	IR	-
공 시	2	공 시 / 상 장	-
국내변호사	5	법률자문	-
미국변호사	5		-

2. 임원의 보수 등

가. 이사·감사 전체의 보수 현황

(1) 주총승인금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기임원	9명	12,000	-

(2) 지급금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사	3	1,918	503	-
사외이사	2	30	15	-
감사위원회 위원 또는 감사	4	45	14	-
계	9	1,993	223	-

※ 인원수는 2014.3.31 현재 기준임.

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 당분기 총액 기준임.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 분기평균인원으로 나누어 계산함.

나. 이사·감사의 개인별 보수 현황

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
박성욱	대표이사	868	-
김준호	이사	556	-

(2) 산정기준 및 방법

구분	개인별 보수 산정기준 및 방법
----	------------------

박성욱	<p>■보수 총액 868백만원은 근로소득,기타소득 및 퇴직소득을 합산한 금액임 - 근로소득: 급여 170백만원, 성과급 698백만원 - 기타소득 및 퇴직소득: 해당 사항 없음</p> <p>■보수산정 기준 및 방법 - 급여 170백만원: Position Grade에 따라 산정된 '14년 연봉 기준 보고기간 지급액 - 성과급 698백만원: '13년말 기준의 경영성과급(Target Incentive, Profit Sharing으로 구성) - 기타소득 및 퇴직소득은 해당 사항 없음</p>
김준호	<p>■보수 총액 556백만원은 근로소득, 기타소득 및 퇴직소득을 합산한 금액임 - 근로소득: 급여 135백만원, 성과급 421백만원 - 기타소득 및 퇴직소득: 해당 사항 없음</p> <p>■보수산정 기준 및 방법 - 급여 135백만원: Position Grade에 따라 산정된 '14년 연봉 기준 보고기간 지급액 - 성과급 421백만원: '13년말 기준의 경영성과급(Target Incentive, Profit Sharing으로 구성) - 기타소득 및 퇴직소득은 해당 사항 없음</p>

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

※ 해당사항 없음.

라. 임원배상책임보험 가입 현황

(1) 보험의 개요

[2014. 03. 31 현재]

(단위 : 백만원)

보험의 명칭	보험료납입액		부보(보상) 한도	비 고
	당기 납입액	누적납입액 (당기분 포함)		
임원배상책임보험	38	38	50,000	

(2) 피보험자

회사 및 회사의 과거·현재·미래의 모든 임원으로 보험기간 중 선임, 퇴임 임원을 모두 포함합니다.

(3) 보상하는 손해

임원의 업무상 과실 및 임원으로서 의무위반으로 최초 제기된 손해배상 청구에 따른 주주 또는 제 3자에 대한 손해배상책임을 보상하며, 임원의 손해배상청구에 대해 회사가 해당임원에게 지급한 회사발생 손해를 보상합니다.

(4) 보험회사의 면책사항

- 보험개시일 이전의 원인행위로 인해 발생한 손해배상
- 법령을 위반하여 발생한 환경오염에 대해 제기되는 손해배상청구
- 임원의 범죄행위(사기, 횡령, 배임 등)로 인한 손해배상청구

IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수 이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
SK hynix America Inc.(SKHYA)	계열사	단기 대여금	47,489 (USD45,000,000)	607	-	48,096 (USD45,000,000)	74 (USD69,517)	거래기간: 2010.11.16 ~ 2014.11.15
SK hynix memory solutions Inc. (SKHMS)	계열사	장기 대여금	5,277 (USD5,000,000)	67	-	5,344 (USD5,000,000)	1 (USD857)	거래기간: 2012.09.27 ~ 2015.09.27
		장기 대여금	5,277 (USD5,000,000)	67	-	5,344 (USD5,000,000)	7 (USD6,864)	거래기간: 2012.11.20 ~ 2015.09.27
합 계			58,043	741	-	58,784	82	-

※ 당기 중 증감분에는 환율변동으로 인한 외화평가금액이 반영되었음.

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래금액	거래내용	비고
SK네트웍스(주)	계열회사	2014.03.31	매입대금 지급일	3,050	비오토피아 타운하우스 매입	부가세 제외 금액

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 · 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	제 목	신고한 내용	신고사항의 진행상황
2014.03.14	기타 주요경 영사항 (자율공시)	손해배상 청구소송 제기의 건	일본의 도시바사는 당사를 상대로 부정경쟁방지법에 의한 손해배상 등을 청구하는 민사소송을 도쿄 지방법원에 제기 하였습니다. 하지만 당사는 상기건과 관련하여 소장을 송달받기 전이며, 추후소장이 송달되는 시점에 제공시 여부를 검토할 예정입니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 66기 정기주주총회 (2014.03.21)	제66기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보: 임형규)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후 보: 최종원)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 120억원)	
	임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	
제 65기 정기주주총회 (2013.03.22)	제65기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보: 김준호)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	
제 64기 정기주주총회 (2012.03.23)	제64기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	
임시주주총회 (2012.02.13)	정관 변경의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	

	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
제 63기 정기주주총회 (2011.03.30)	제63기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

□ SanDisk Corporation과 Toshiba Corporation의 영업비밀 침해 소송

2014년 3월 13일 Toshiba Corporation은 지배기업을 상대로 Toshiba Corporation의 영업비밀을 침해하였다는 소송을 일본 도쿄지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 Toshiba Corporation이 제기한 소송의 소장은 송달되지 않은 상태입니다.

한편, 동일자에 SanDisk Corporation은 지배기업과 종속기업 SK hynix America Inc. 및 SK hynix memory solutions Inc.를 SanDisk Corporation과 Toshiba Corporation이 공동 소유한 영업비밀을 침해했다는 이유로 미국 캘리포니아 산타클라라지방법원에 소송을 제기하였습니다. 현재 미국 지역에서 제기된 SanDisk Corporation의 영업비밀침해 관련 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태로 해당 소장은 지배기업에 송달된 상태입니다. 상기 소송은 당분기말 현재 극초기단계로서, 해당 산타클라라지방법원에서 Complex case를 이유로 2014년 7월 18일까지 소송의 모든 진행을 중지시킨 상태입니다.

당분기말 현재 이러한 우발상황의 최종결과는 예측할 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

□기타의 소송 및 특허 claim 등

연결실체는 상기 소송을 포함하여 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. 그러나 당분기말 현재 이러한 우발상황의 최종결과는 예측할 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

나. 채무보증 현황

(단위: 백만원)

채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고
-----	-----	------	--------	--------	----

(회사와의 관계)				(개시일~종료일)	
종업원	한국외환은행, 국민은행	28	28	2000.12.06 ~	- 우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

다. 그 밖의 우발채무 등

□ 특허라이선스 계약

연결실체는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

□ 공업용수공급계약

연결실체는 2001년에 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 2001년 3월부터 2013년3월까지 총 12년간 공업용수를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 2006년 12월에 2018년 3월까지의 연장계약을 체결하였으며 이후 공장 등 신설공사에 따른 수정계약을 체결한 바 있습니다. 동 계약에 의하면 연결실체는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

□ HITECH와 후공정서비스계약

연결실체는 2009년 중 HITECH과 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 HITECH은 지배기업 및 지배기업의 종속기업인 SKHYMC로부터 기계장치를매입하기로 계약하였으며, 설립 후 5년 동안 회사에 대한 후공정 서비스 제공을 위하여 동 매입 장비를 배타적으로 사용하기로 하였습니다. 이후 연결실체는 2011년 중 HITECH과 기존 후공정 서비스 공급계약과 연계하여 모듈서비스 공급을 추가하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 연결실체는 HITECH에 일정액의 약정수익을보장하는 후공정서비스 가격을 지불하기로 하였습니다..

라. 사모자금의 사용내역

2012년 2월 당사 보통주 101,850,000주에 대한 제3자배정 방식의 유상증자 결과(발행가액: 23,000원), 2012년 2월 14일 2,342,550백만원의 대금이 납입되었으며, 당사는 시설자금결제와 운영자금결제 및 기타비용으로 자금을 집행하여 본 보고서 제출일 현재 사모자금의 사용을 모두 완료하였습니다.

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등
주권상장법인사모증자 (증권시장사모)	2012년 02월 14일	2,342,550	-	- 운영자금: 2,107,816 - 시설자금: 218,161 - 기타(발행비용): 16,573	-

3. 녹색경영 현황

가. 온실가스·에너지 관리업체 지정

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스·에너지 관리업체 지정·관리 지침(환경부 고시 제2010-109호)'에 따라 2010년 9월 30일 산업·발전 부분 관리 업체로 지정되었습니다.

매년 주어지는 온실가스 및 에너지 배출 할당량을 달성하기 위해 당사는 온실가스 에너지 목표관리제 TF를 조직하여 기후변화의 영향에 신속하고 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2013년 온실가스 배출량은 2,866,850톤 CO₂e (tCO₂e), 에너지 사용량은 38,969 테라줄(TJ)입니다.

4. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

가. 가족친화기업 인증

당 인증은 '가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률' 제15조에 따라 가족친화 사회환경의 조성을 촉진하기 위하여 가족친화 제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 하는 인증 제도입니다.

당사는 구성원, 고객, 주주, 투자자, 협력업체 등 모든 이해관계자의 행복을 목표로 삼고 노력을 기울여왔으며 구성원의 행복증진을 위해 다양한 가족친화경영 프로그램을 운영하고 있습니다.

이러한 성과를 인정받아 2009년 11월 17일 제조분야 대기업 및 전자업계 최초로 가족친화기업 인증을 받았고, 2012년에 인증연장을 받았습니다.

XI. 재무제표 등

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 67 기 1분기말 2014.03.31 현재

제 66 기말 2013.12.31 현재

제 65 기말 2012.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 67 기 1분기말	제 66 기말	제 65 기말
자산			
유동자산	7,154,389	6,653,124	5,313,573
현금및현금성자산	319,961	631,867	658,387
단기금융상품	2,818,066	2,154,532	1,126,229
매출채권	2,324,972	1,941,675	1,719,521
기타수취채권	200,395	323,759	125,055
기타금융자산	29,611	245,808	
재고자산	1,261,807	1,178,300	1,509,331
당기법인세자산	1,521	9,242	12,719
매각예정자산	26,896	26,557	26,958
기타유동자산	171,160	141,384	135,373
비유동자산	14,911,350	14,144,174	13,335,120
조인트벤처 및 관계기업 투자	108,630	107,097	104,100
매도가능금융자산	162,052	158,770	44,297
기타수취채권	44,954	43,090	19,127
기타금융자산	1,914	2,017	525
유형자산	12,854,615	12,129,797	11,586,192
무형자산	1,124,984	1,110,403	983,630
투자부동산	26,909	28,609	29,888
이연법인세자산	203,016	198,570	378,366
기타비유동자산	384,276	365,821	188,995
자산총계	22,065,739	20,797,298	18,648,693
부채			
유동부채	3,964,668	3,078,239	4,441,180
매입채무	699,148	648,793	592,738
미지급금	1,086,891	788,304	381,260
기타지급채무	414,972	677,120	361,076

차입금	1,495,661	870,320	2,719,197
기타금융부채	312	2,194	17,020
유동충당부채	46,926	52,584	330,615
당기법인세부채	175,607	12,084	13,368
기타유동부채	45,151	26,840	25,906
비유동부채	4,248,695	4,652,200	4,468,071
기타지급채무	171,928	177,101	97,533
차입금	3,268,517	3,679,895	3,752,779
기타금융부채	91,222	107,094	1,615
확정급여부채	664,009	635,740	575,096
기타비유동부채	53,019	52,370	41,048
부채총계	8,213,363	7,730,439	8,909,251
자본			
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	13,853,030	13,067,243	9,740,156
자본금	3,568,645	3,568,645	3,488,419
자본잉여금	3,406,083	3,406,083	3,053,874
기타포괄손익누계액	(125,534)	(108,807)	(115,402)
이익잉여금(결손금)	7,003,836	6,201,322	3,313,265
비지배지분	(654)	(384)	(714)
자본총계	13,852,376	13,066,859	9,739,442
자본과부채총계	22,065,739	20,797,298	18,648,693

연결 포괄손익계산서

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 66 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 67 기 1분기		제 66 기 1분기		제 66 기	제 65 기
	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	3,742,690	3,742,690	2,781,147	2,781,147	14,165,102	10,162,210
매출원가	2,110,422	2,110,422	2,018,229	2,018,229	8,864,587	8,550,989
매출총이익	1,632,268	1,632,268	762,918	762,918	5,300,515	1,611,221
판매비와경상개발비	575,002	575,002	445,967	445,967	1,920,730	1,838,570
영업이익(손실)	1,057,266	1,057,266	316,951	316,951	3,379,785	(227,349)
금융수익	131,714	131,714	142,993	142,993	560,570	689,709
금융비용	156,457	156,457	258,214	258,214	747,329	682,594
지분법 손익	388	388	3,614	3,614	19,256	16,713
기타영업외수익	6,885	6,885	17,561	17,561	368,513	67,130
기타영업외비용	70,307	70,307	14,688	14,688	505,870	62,910
법인세비용차감전순이익(손실)	969,489	969,489	208,217	208,217	3,074,925	(199,301)

법인세비용	167,235	167,235	29,504	29,504	202,068	(40,506)
당기순이익(손실)	802,254	802,254	178,713	178,713	2,872,857	(158,795)
기타포괄손익	(16,737)	(16,737)	125,142	125,142	22,125	(305,601)
보험수리적손익	(24)	(24)	(16)	(16)	15,587	(82,872)
매도가능금융자산평가손익	3,418	3,418	6,575	6,575	(655)	(1,896)
해외사업환산손익	(21,276)	(21,276)	114,902	114,902	8,419	(216,490)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지 분	1,145	1,145	3,681	3,681	(1,226)	(4,343)
총포괄손익 소계	785,517	785,517	303,855	303,855	2,894,982	(464,396)
당기순이익(손실)의 귀속						
지배기업의 소유지분	802,538	802,538	178,595	178,595	2,872,470	(158,886)
비지배지분	(284)	(284)	118	118	387	91
총포괄손익의 귀속						
지배기업의 소유지분	785,787	785,787	303,623	303,623	2,894,652	(464,267)
비지배지분	(270)	(270)	232	232	330	(129)
지배기업의 소유지분에 대한 주당이익						
기본주당이익(원)	1,130	1,130	257	257	4,045	(233)
희석주당이익(원)	1,104	1,104	257	257	4,045	(233)

연결 자본변동표

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
제 66 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지
제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본							비지배지분	자본 합계	
		지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본									
		자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계 액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유 주에게 귀속되는 자본 합계				
2012.01.01 (기초자본)		2,978,498	1,229,052	107,107	5,762	3,555,323	7,875,742	(471)	7,875,271		
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				(158,886)	(158,886)	91	(158,795)		
		보험수리적손익				(82,872)	(82,872)		(82,872)		
		매도가능금융자산평가손익			(1,896)			(1,896)		(1,896)	
		부의지분법자본변동			(4,343)			(4,343)		(4,343)	
		해외사업환산손익			(216,270)			(216,270)	(220)	(216,490)	
		총포괄손익			(222,509)		(241,758)	(464,267)	(129)	(464,396)	
	자본에적립된 영원 소유주 와의 거래	유상증자 연차배당 전환사채의 전환 주식선택권 행사 주식선택권 소멸 종속기업의 지분율변동효과 연결범위의 변동 지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 지배기업의 소유 지분 변동 기타의 변동 자본에적립방법영원 소유주와의 거래 소계	유상증자	509,250	1,816,726				2,325,976	2,325,976	
			연차배당								
			전환사채의 전환	52	210				262		262
			주식선택권 행사	619	4,440		(2,200)		2,819		2,819
			주식선택권 소멸		3,562		(3,562)				
			종속기업의 지분율변동효과								
			연결범위의 변동								
			지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 지배기업의 소유			(76)			(76)	(105)	(181)
			지분 변동								
기타의 변동					(300)	(300)	(9)	(309)			
자본에적립방법영원 소유주와의 거래 소계	509,921	1,824,822		(5,762)	(300)	2,328,681	(114)	2,328,567			

2012.12.31 (기말자본)		3,488,419	3,053,874	(115,402)		3,313,265	9,740,156	(714)	9,739,442	
2013.01.01 (기초자본)		3,488,419	3,053,874	(115,402)		3,313,265	9,740,156	(714)	9,739,442	
자본의 변동	포괄손익	당기손이익(손실)				2,872,470	2,872,470	387	2,872,857	
		보험수리적손익				15,587	15,587		15,587	
		매도가능금융자산평가손익			(655)		(655)		(655)	
		부의지분법자본변동			(1,226)		(1,226)		(1,226)	
		해외사업환산손익			8,476		8,476	(57)	8,419	
		총포괄손익			6,595		2,888,057	2,894,652	330	2,894,982
	자본에직접변영원 소유주와의 거래	유상증자								
		연차배당								
		전환사채의 전환	80,226	352,209				432,435		432,435
		주식선택권 행사								
		주식선택권 소멸								
		종속기업의 지분율변동효과								
		연결범위의 변동								
		지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지배기업의 소유지분 변동								
		기타의 변동								
		자본에직접변영원 소유주와의 거래 소계	80,226	352,209				432,435		432,435
		2013.12.31 (기말자본)		3,568,645	3,406,083	(108,807)		6,201,322	13,067,243	(384)
2013.01.01 (기초자본)		3,488,419	3,053,874	(115,402)		3,313,265	9,740,156	(714)	9,739,442	
자본의 변동	포괄손익	당기손이익(손실)				178,595	178,595	118	178,713	
		보험수리적손익				(16)	(16)		(16)	
		매도가능금융자산평가손익			6,575		6,575		6,575	
		부의지분법자본변동			3,681		3,681		3,681	
		해외사업환산손익			114,788		114,788	114	114,902	
		총포괄손익			125,044		178,579	303,623	232	303,855
	자본에직접변영원 소유주와의 거래	유상증자								
		연차배당								
		전환사채의 전환	48	201				249		249
		주식선택권 행사								
		주식선택권 소멸								
		종속기업의 지분율변동효과								
		연결범위의 변동								
		지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지배기업의 소유지분 변동								
		기타의 변동								
		자본에직접변영원 소유주와의 거래 소계	48	201				249		249
		2013.03.31 (기말자본)		3,488,467	3,054,075	9,642		3,491,844	10,044,028	(482)
2014.01.01 (기초자본)		3,568,645	3,406,083	(108,807)		6,201,322	13,067,243	(384)	13,066,859	
자본의 변동	포괄손익	당기손이익(손실)				802,538	802,538	(284)	802,254	
		보험수리적손익				(24)	(24)		(24)	
		매도가능금융자산평가손익			3,418		3,418		3,418	
		부의지분법자본변동			1,145		1,145		1,145	
		해외사업환산손익			(21,290)		(21,290)	14	(21,276)	
		총포괄손익			(16,727)		802,514	785,787	(270)	785,517
	자본에직접변영원 소유주와의 거래	유상증자								
		연차배당								
		전환사채의 전환								
		주식선택권 행사								
		주식선택권 소멸								
		종속기업의 지분율변동효과								
		기타의 변동								

	연결범위의 변동								
	지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 지배기업의 소유 지분 변동								
	기타의 변동								
	자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계								
2014.03.31 (기말자본)		3,568,645	3,406,083	(125,534)		7,003,836	13,853,030	(654)	13,852,376

연결 현금흐름표

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 66 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 67 기 1분기	제 66 기 1분기	제 66 기	제 65 기
영업활동현금흐름	1,210,525	945,760	6,372,056	2,211,651
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,228,284	990,056	6,521,553	2,420,894
이자수취	17,132	7,169	58,888	81,931
이자지급	(39,137)	(50,738)	(199,553)	(275,169)
배당금수취	4	1,362	17,414	12,098
법인세의환급(납부)	4,242	(2,089)	(26,246)	(28,103)
투자활동현금흐름	(1,713,446)	(648,671)	(4,892,125)	(4,698,379)
단기금융상품의 감소	3,616,041	354,349	3,927,831	2,754,789
단기금융상품의 증가	(4,273,064)	(413,645)	(4,956,446)	(3,252,006)
기타수취채권의 감소	365	477	2,728	11,640
기타수취채권의 증가	(2,415)	(846)	(5,969)	(8,661)
매도가능금융자산의 처분	768	119	331	11,190
매도가능금융자산의 취득	(325)	(852)	(115,564)	(3,618)
기타금융자산의 감소	245,847		29,681	
기타금융자산의 증가	(30,072)	(29,977)	(276,591)	
파생상품거래로 인한 현금유입		463	3,656	2,419
파생상품거래로 인한 현금유출	(1,867)	(1,515)	(6,550)	(44,507)
유형자산의 처분	26,575	9,553	15,509	35,809
유형자산의 취득	(1,230,914)	(497,484)	(3,205,797)	(3,772,879)
무형자산의 처분		200	200	1,226
무형자산의 취득	(64,887)	(69,513)	(301,496)	(159,072)
투자부동산의 처분				
정부보조금의 수령	502			
관계기업투자의 취득				

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름				
종속기업의 지배력획득			(3,648)	(274,732)
매각예정자산의 처분				23
재무활동현금흐름	189,835	(220,761)	(1,499,989)	1,917,122
차입금의 증가	1,347,321	1,217,425	3,528,687	6,966,003
차입금의 상환	(1,157,486)	(1,438,186)	(5,028,676)	(7,377,491)
보통주의 발행				2,328,791
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동				(181)
'배당금의 지급				
현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	1,180	6,396	(6,462)	(15,795)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(311,906)	82,724	(26,520)	(585,401)
기초현금및현금성자산	631,867	658,387	658,387	1,243,788
기말현금및현금성자산	319,961	741,111	631,867	658,387

2. 재무제표(별도)

재무상태표

제 67 기 1분기말 2014.03.31 현재

제 66 기말 2013.12.31 현재

제 65 기말 2012.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 67 기 1분기말	제 66 기말	제 65 기말
자산			
유동자산	6,550,976	5,798,909	4,695,907
현금및현금성자산	128,722	371,204	477,747
단기금융상품	2,785,958	2,115,581	1,074,661
매출채권	2,194,949	1,803,460	1,622,659
기타수취채권	227,244	207,625	184,907
기타금융자산	29,611	245,808	
재고자산	1,024,376	920,590	1,199,485
당기법인세자산		7,731	11,014
기타유동자산	160,116	126,910	125,434
매각예정자산			
비유동자산	14,767,888	14,097,350	13,507,577

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,358,535	3,326,243	3,259,185
매도가능금융자산	161,657	158,374	43,901
기타수취채권	48,655	46,361	20,065
기타금융자산	479	594	521
유형자산	9,846,700	9,243,030	8,944,484
무형자산	830,786	819,009	713,688
투자부동산	26,909	28,609	29,888
이연법인세자산	110,682	110,254	307,918
기타비유동자산	383,485	364,876	187,927
자산총계	21,318,864	19,896,259	18,203,484
부채			
유동부채	3,352,546	2,476,997	4,240,679
매입채무	752,029	661,059	737,207
미지급금	916,308	595,959	377,239
기타지급채무	370,886	598,456	335,020
차입금	1,056,958	547,836	2,427,207
기타금융부채	312	267	13,764
유동충당부채	59,395	62,387	335,752
당기법인세부채	166,491		
기타유동부채	30,167	11,033	14,490
비유동부채	3,884,955	4,216,651	4,003,162
기타지급채무	163,023	168,158	79,614
차입금	2,926,304	3,264,565	3,317,533
기타금융부채	91,222	107,094	1,615
퇴직급여부채	653,876	626,906	565,495
기타비유동부채	50,530	49,928	38,905
부채총계	7,237,501	6,693,648	8,243,841
자본			
자본금	3,568,645	3,568,645	3,488,419
자본잉여금	3,444,363	3,444,363	3,092,155
기타포괄손익누계액	11,242	7,824	8,479
이익잉여금(결손금)	7,057,113	6,181,779	3,370,590
자본총계	14,081,363	13,202,611	9,959,643
자본과부채총계	21,318,864	19,896,259	18,203,484

포괄손익계산서

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 66 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 67 기 1분기		제 66 기 1분기		제 66 기	제 65 기
	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	3,716,317	3,716,317	2,775,226	2,775,226	13,896,309	10,001,783
매출원가	2,096,805	2,096,805	2,148,324	2,148,324	8,947,323	8,947,795
매출총이익	1,619,512	1,619,512	626,902	626,902	4,948,986	1,053,988
판매비와경상개발비	533,316	533,316	404,416	404,416	1,733,870	1,670,273
영업이익(손실)	1,086,196	1,086,196	222,486	222,486	3,215,116	(616,285)
금융수익	113,432	113,432	108,084	108,084	459,701	627,348
금융비용	120,801	120,801	240,066	240,066	669,239	606,002
기타영업외수익	6,116	6,116	9,973	9,973	36,604	64,646
기타영업외비용	40,701	40,701	10,249	10,249	47,240	46,584
법인세비용차감전순이익(손실)	1,044,242	1,044,242	90,228	90,228	2,994,942	(576,877)
법인세비용	168,884	168,884	6,377	6,377	197,975	(86,887)
당기순이익(손실)	875,358	875,358	83,851	83,851	2,796,967	(489,990)
기타포괄손익	3,394	3,394	6,559	6,559	13,567	(82,485)
매도가능금융자산평가손익	3,418	3,418	6,575	6,575	(655)	(1,896)
보험수리적손익	(24)	(24)	(16)	(16)	14,222	(80,589)
총포괄손익 소계	878,752	878,752	90,410	90,410	2,810,534	(572,475)
지배기업의 소유지분에 대한 주 당이익						
기본주당이익(원)	1,233	1,233	121	121	3,938	(719)
계속영업기본주당이익(손실)	1,233	1,233	121	121	3,938	(719)
희석주당이익(원)	1,204	1,204	121	121	3,938	(719)
계속영업희석주당이익(손실)	1,204	1,204	121	121	3,938	(719)

자본변동표

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 66 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본					
		자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
2012.01.01 (기초자본)		2,978,498	1,267,257	10,375	5,762	3,941,169	8,203,061
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				(489,990)	(489,990)
		보험수리적손익				(80,589)	(80,589)
		매도가능금융자산평가손 익			(1,896)		(1,896)
		총포괄손익			(1,896)		(570,579)
	주식선택권의행사	619	4,400		(2,200)		2,819
	주식선택권의소멸		3,562		(3,562)		
	전환사채의전환	52	210				262

	배당금지금						
	유상증자	509,250	1,816,726				2,325,976
2012.12.31 (기말자본)		3,488,419	3,092,155	8,479		3,370,590	9,959,643
2013.01.01 (기초자본)		3,488,419	3,092,155	8,479		3,370,590	9,959,643
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				2,796,967	2,796,967
		보험수리적손익				14,222	14,222
		매도가능금융자산평가손익			(655)		(655)
		총포괄손익			(655)		2,811,189
	주식선택권의행사						
	주식선택권의소멸						
	전환사채의전환	80,226	352,208				432,434
	배당금지금						
	유상증자						
2013.12.31 (기말자본)		3,568,645	3,444,363	7,824		6,181,779	13,202,611
2013.01.01 (기초자본)		3,488,419	3,092,155	8,479		3,370,590	9,959,643
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				83,851	83,851
		보험수리적손익				(16)	(16)
		매도가능금융자산평가손익			6,575		6,575
		총포괄손익			6,575		83,835
	주식선택권의행사						
	주식선택권의소멸						
	전환사채의전환	48	201				249
	배당금지금						
	유상증자						
2013.03.31 (기말자본)		3,488,467	3,092,356	15,054		3,454,425	10,050,302
2014.01.01 (기초자본)		3,568,645	3,444,363	7,824		6,181,779	13,202,611
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				875,358	875,358
		보험수리적손익				(24)	(24)
		매도가능금융자산평가손익			3,418		3,418
		총포괄손익			3,418		875,334
	주식선택권의행사						
	주식선택권의소멸						
	전환사채의전환						
	배당금지금						
	유상증자						
2014.03.31 (기말자본)		3,568,645	3,444,363	11,242		7,057,113	14,081,363

현금흐름표

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
제 66 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지
제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 67 기 1분기	제 66 기 1분기	제 66 기	제 65 기
영업활동현금흐름	980,029	719,053	5,419,815	924,749

영업으로부터 창출된 현금흐름	993,718	757,646	5,529,830	1,086,482
이자수취	15,961	6,922	54,812	76,376
이자지급	(34,474)	(45,942)	(185,524)	(255,180)
배당금수취		1,362	17,414	18,019
법인세납부(환급)	4,824	(935)	3,283	(948)
투자활동현금흐름	(1,368,316)	(490,988)	(4,006,387)	(3,899,695)
단기금융상품의 감소	3,576,101	320,021	3,789,918	2,354,352
단기금융상품의 증가	(4,240,396)	(370,026)	(4,830,838)	(2,840,486)
기타수취채권의 감소	358	2,124	15,944	40,674
기타수취채권의 증가	(2,225)	(644)	(5,685)	(14,339)
매도가능금융자산의 처분	768	119	331	11,190
매도가능금융자산의 취득	(325)	(852)	(115,565)	(3,387)
기타금융자산의 감소	245,808		29,670	
기타금융자산의 증가	(29,611)	(29,670)	(275,478)	
파생상품거래로 인한 현금유입		463	3,656	2,418
파생상품거래로 인한 현금 유출	(237)	(1,515)	(6,550)	(44,506)
유형자산의 처분	29,160	9,413	42,599	36,139
유형자산의 취득	(851,835)	(372,343)	(2,312,081)	(3,001,628)
무형자산의 처분		200	200	1,226
무형자산의 취득	(64,092)	(48,278)	(275,102)	(158,879)
투자부동산의 처분				
정부보조금수령	502			
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분			2,179	
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(32,292)		(69,585)	(282,492)
기타투자활동으로 인한 현금유출				
매각예정자산의 처분				23
재무활동현금흐름	145,805	(200,784)	(1,519,971)	2,472,334
차입금의 증가	1,232,492	1,053,258	3,184,919	6,538,147
차입금의 상환	(1,086,687)	(1,254,042)	(4,704,890)	(6,394,604)
보통주의발행				2,328,791
배당금의 지급				
지배력을 상실하지 않은 종속기업에 대한 소유지분의 변동				
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(20)		
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(242,482)	27,261	(106,543)	(502,612)
기초현금및현금성자산	371,204	477,747	477,747	980,359
기말현금및현금성자산	128,722	505,008	371,204	477,747

3. 대손충당금 설정현황

가. 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제67기 1분기	매출채권	2,329,404	4,432	0
	장·단기 대여금	9,491	6	0
	장·단기 미수금	218,771	13,042	6
	장·단기 미수수익	10,448	0	0
	장·단기 보증금	16,616	237	1
	장·단기 예치금	4,492	1,184	26
	장기성 외상매출금	139	139	100
	합 계	2,589,362	19,042	1
제66기 연간	매출채권	1,945,121	3,446	0
	장·단기 대여금	9,329	6	0
	장·단기 미수금	341,621	13,054	4
	장·단기 미수수익	11,071	0	0
	장·단기 보증금	15,027	222	1
	장·단기 예치금	4,253	1,171	28
	장기성 외상매출금	119	119	100
	합 계	2,326,541	18,019	1
제65기 연간	매출채권	1,722,778	3,257	0
	장·단기 대여금	8,459	6	0
	장·단기 미수금	128,016	15,950	12
	장·단기 미수수익	8,569	0	0
	장·단기 보증금	12,039	179	1
	장·단기 예치금	4,796	1,561	33
	장기성 외상매출금	176	176	100
	합 계	1,884,834	21,131	1

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제67기 1분기	제66기	제65기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	18,019	21,131	21,764

2. 순대손처리액(① - ②±③)	27	430	-
① 대손처리액(상각채권액)	27	430	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	1,050	(2,682)	(633)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	19,042	18,019	21,131

* 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분		설정 기준
매출채권	1)정상채권	-.과거 경험률을 바탕으로 설정
	2)장기채권	-.거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -.담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -.담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

* 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 :백만원, %)

구분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	일반	2,311,439	137	133	887	2,312,596
	특수관계자	16,808	0	0	0	16,808
	계	2,328,247	137	133	887	2,329,404
구성비율		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

4. 재고자산 현황 등

가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제67기 1분기	제66기	제65기	비고
반도체	제품	447,595	345,872	563,251	-
	재공품	593,695	608,402	683,352	-
	원재료	129,601	141,625	175,986	-
	저장품	62,685	45,672	42,165	-

	미착품	28,231	36,729	44,577	-
	합 계	1,261,807	1,178,300	1,509,331	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]		5.7%	5.7%	8.1%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		6.9회	6.6회	6.4회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2014-01-01	삼일회계법인/ 삼정회계법인	
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			
원부자재			
제품	2013-02-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2013-01-01	삼일회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2011-12-01	삼일회계법인/ 삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2011-01-01	한영회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2010-01-01	한영회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
	2009-12-30		-

5. 채무증권 발행실적 등

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
SK하이닉스 (주)	회사채	공모	2011년 01월 14일	200,000	6.35	BBB+ (NICE신평/한기평/한신평)	2015년 01월 14일	미상환	우리투자증권

SK하이닉스 (주)	회사채	공모	2011년 05월 06일	400,000	6.20	A- (NICE신평/한기평/한신평)	2016년 05월 06일	미상환	NH투자증권
SK하이닉스 (주)	회사채	공모	2012년 09월 04일	200,000	3.72	A (NICE신평/한기평/한신평)	2017년 09월 04일	미상환	신한금융투자
SK하이닉스 (주)	회사채	사모	2012년 05월 30일	550,000	5.35	A (NICE신평/한기평/한신평)	2019년 05월 30일	미상환	삼성증권
SK하이닉스 (주)	회사채	공모	2010년 05월 14일	534,400	2.65	B1(Moody's), B+(S&P)	2015년 05월 14일	미상환	Credit Suisse
SK하이닉스 (주)	회사채	사모	2012년 06월 20일	106,880	3M Libor +2.85%	A(S&P)	2017년 06월 20일	미상환	Shinhan Asia Limited
SK하이닉스 (주)	기업어음 증권	사모	2012년 05월 25일	100,000	3.90	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2015년 05월 26일	미상환	동양증권
SK하이닉스 (주)	기업어음 증권	사모	2012년 05월 25일	100,000	3.90	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2015년 05월 26일	미상환	한양증권
SK하이닉스 (주)	기업어음 증권	사모	2012년 06월 20일	20,000	3.63	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2014년 06월 24일	미상환	하이투자증권
SK하이닉스 (주)	기업어음 증권	사모	2012년 06월 20일	80,000	3.63	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2014년 06월 24일	미상환	KTB증권
SK하이닉스 (주)	기업어음 증권	사모	2012년 07월 05일	70,000	3.63	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2014년 07월 07일	미상환	한양증권
합 계	-	-	-	2,361,280	-	-	-	-	-

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 기준일의 환율을 적용하였습니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	100,000	70,000	-	200,000	-	370,000
	합계	-	-	100,000	70,000	-	200,000	-	370,000

다. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과	30일초과	90일초과	180일초과	합 계	발행 한도	잔여 한도
------	--------	-------	-------	-------	--------	-----	-------	-------

			30일이하	90일이하	180일이하	1년이하			
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	200,000	534,400	400,000	200,000	-	-	-	1,334,400
	사모	-	-	-	106,880	-	550,000	-	656,880
	합계	200,000	534,400	400,000	306,880	-	550,000	-	1,991,280

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XII. 부속명세서

1. 공정가치평가 절차요약

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

수준	내용
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
수준 2	준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수
수준 3	자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	1,156,355	-	1,156,355	-	1,156,355
기타금융자산	157	-	157	-	157
매도가능금융자산	35,471	35,471	-	-	35,471
합 계	1,191,983	35,471	1,156,512	-	1,191,983
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	319,961	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,661,711	-	-	-	-
매출채권(*1)	2,324,972	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	245,349	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	31,368	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	126,581	-	-	-	-
합 계	4,709,942	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	91,534	-	91,534	-	91,534
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	699,148	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,086,891	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	586,900	-	-	-	-
차입금	2,801,282	-	2,828,058	-	2,828,058
사 채	1,962,896	-	2,053,823	-	2,053,823

합 계	7,137,117	-	4,881,881	-	4,881,881
-----	-----------	---	-----------	---	-----------

<전기말>

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	1,045,974	-	1,045,974	-	1,045,974
기타금융자산	272	-	272	-	272
매도가능금융자산	31,966	31,966	-	-	31,966
합 계	1,078,212	31,966	1,046,246	-	1,078,212
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	631,867	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,108,558	-	-	-	-
매출채권(*1)	1,941,675	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	366,849	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	247,553	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	126,804	-	-	-	-
합 계	4,423,306	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	109,288	-	109,288	-	109,288
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	648,793	-	-	-	-
미지급금(*1)	788,304	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	854,221	-	-	-	-
차입금	2,600,503	-	2,629,717	-	2,629,717
사 채	1,949,712	-	2,155,463	-	2,155,463
합 계	6,841,533	-	4,785,180	-	4,785,180

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 동일한 상품(즉 수준1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호'금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정하였습니다.

연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다.

구분	공정가치	수준	평가기법
단기금융상품:			
당기손익인식금융자산	1,156,355	2	현재가치기법
파생상품자산:			
이자율스왑	157	2	현재가치기법

파생상품부채:			
이자율스왑	312	2	현재가치기법
전환옵션	91,222	2	옵션가격결정모형

2. 유형자산의 공정가치와 그 평가방법

당사는 한국채택국제회계기준 2011년 도입을 위해 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준 최초채택' 규정에 의거 토지자산의 개별항목별 공정가치를 간주원가로 사용하였습니다.

당사의 토지자산에 대한 공정가치 평가는 다음과 같습니다.

(1) 평가기관: (주)가온감정평가법인

(2) 평가대상: 유형자산 중 토지자산

(3) 평가금액: 4,383억원

(4) 공정가액 추정시 사용한 방법 및 중요한 가정

:전문 감정평가기관(가온감정평가법인)의 감정평가를 기초로 회사 토지에 대한 재평가를 수행하였으며, 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한법률」에 의거 공시지가를 기준하여 평가한 금액과 「감정평가에 관한 규칙」 제10조제1항의 규정에 따라 원가방식, 비교방식, 수익방식의 세가지 방식 중 대상 부동산의 성격, 평가목적 또는 평가조건을 고려하여 적정하다고 판단되는 거래사례비교법에 의한 시산가격을 비교·검토하여 최종 평가금액을 산정함.

(5) 원가모형 비교

:재평가된 유형자산이 토지에 대해 원가모형을 적용하여 평가하였을 경우 장부금액은 2,567억원입니다.

공정가치평가 결과는 한국채택국제회계기준 도입기준일인 2011년 1월 1일에 장부에 반영하고, 한국채택국제회계기준 전환일인 2010년 1월 1일의 재무상태표에 포함하여 비교 표시하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.